



การปั้นโลหะอิเล็กทรอนิกซ์ InGaAs ( $E_i \approx 0.75$  eV) บนผ้าที่ผลิตด้วยวิธีการปั้นโลหะอิเล็กทรอนิกซ์จากล้ำในประเทศ  
(100) GaAs ด้วยวิธีการปั้นโลหะอิเล็กทรอนิกซ์จากล้ำในประเทศ

โดย

ดร. ดร. สมชัย วัฒนาธรรมพันธ์ D. Eng. (Chula)

โครงการวิจัยเลขที่ 81G-EE-2548  
ทุนงานประจำมหาวิทยาลัย ปี 2548

สถาบันวิจัยและบริการ  
คุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
กุญ邦ฯ  
ตุลาคม 2550

คณะกรรมการค่าสัตหีป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่รับผิดชอบต่อผลเสียใดๆ  
อันอาจเกิดจากการนำความคิดเห็นในเอกสารฉบับนี้ไปใช้ ความคิดเห็น  
ที่ปรากฏในเอกสารเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็น  
ความคิดเห็นของคณะฯ

## สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การปูร์กผลึกอิพิเทกซ์ InGaAs ( $E_g \approx 0.75$  eV) บนแผ่นผลึกฐานเริ่มต้น (100) GaAs  
ด้วยวิธีการปูร์กผลึกอิพิเทกซ์จากกลั่นโมเลกุล

โดย

รศ.ดร. สมชัย รัตนธรรมพันธุ์ D. Eng. (Chula)

โครงการวิจัยเลขที่ 81G-EE-2548

ทุนงบประมาณแผ่นดิน ปี 2548

# สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุงเทพฯ

ตุลาคม 2550

## กิตติกรรมประกาศ

ส่วนหนึ่งของงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2548 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ที่ได้ให้การสนับสนุนและคำแนะนำซึ่งแน่นหนาที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการวิจัยนี้ ขอบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร. ปิยะสาร ประเสริฐธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วงศ์ ปัวจารย์ แห่งภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้อนุเคราะห์เอื้อเพื่อเครื่อง XRD Prof. Yoshiaki NAKANO แห่ง University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่นที่ได้อธิบายเครื่อง XRD สำหรับการเปรียบเทียบตัวอย่างมาตรฐานและชุดระบบบัวด์ โฟโต้ลูมิเนสเซนซ์ พร้อมทั้งคุณศุภโชค ไวยน้อย คุณวัฒน์เรือน ไวยน้อย คุณพรวชัย ช่างม่วง คุณปุณยศิริ บุญเปี๊ง และคุณองอาจ ตั้งเมตตาจิตดุล ที่ให้ความช่วยเหลือในการวิจัยนี้

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขหนุ่ง	เลขทะเบียน 013643
วัน, เดือน, ปี ๓๐๖๔, ก. ๕๙	

## บทคัดย่อ

ในงานวิจัยนี้ได้มีศึกษาอิทธิพลของเงื่อนไขในการปั้กผลึกอิพิแทกซ์ InGaAs บนแผ่นพลีกฐาน (100) GaAs ด้วยวิธีการปั้กผลึกอิพิแทกซ์จากคำโน้มเลกุล คุณภาพผิวน้ำของผลึกที่ได้มีลักษณะเรียบ มันเงาคล้ากระเจา สำหรับการวิเคราะห์ความเรียบของผิวน้ำ (Surface roughness) ของชั้นผลึกที่ปั้ก ได้กระทำโดยใช้เครื่อง Atomic Force Microscope (AFM) โดยทำการศึกษาอิทธิพลของค่าอุณหภูมิแผ่น พลีกฐานขณะทำการปั้กผลึกและค่าความดันไอ As<sub>4</sub> ที่มีผลต่อคุณสมบัติของชั้นผลึกอิพิแทกซ์ InGaAs พบว่าชั้นผลึกอิพิแทกซ์ InGaAs ที่ไม่มีการเจือมีคุณสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดเดิมและแสดงค่าความ หนาแน่นพานาไฟฟ้ามีค่าอยู่ในช่วง  $1.68 \times 10^{16} - 4.48 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$  และค่าความคล่องพาหะอยู่ในช่วง 700-1,791  $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$  จากการวัดด้วยวิธี van der PAUW ที่อุณหภูมิห้อง จากผลที่ได้ในงานวิจัยนี้ ให้เห็น ว่าคุณภาพของชั้นผลึกอิพิแทกซ์ InGaAs ที่ปั้กได้ขึ้นกับเงื่อนไขต่างๆ ที่ใช้ในการปั้กผลึก ได้แก่ ค่า อุณหภูมิแผ่นผลึกขณะทำการปั้กผลึกมีค่าในช่วง 440-480 °C และค่าความดันไอ As<sub>4</sub> มีค่าอยู่ในช่วง  $3.3 \times 10^{-6} - 1.5 \times 10^{-5} \text{ Torr}$  นอกจากนี้ผลการวัดไฟโคลูมิเนสเซนซ์ของตัวอย่างในการทดลองนี้ ไม่สามารถวัด ได้ เนื่องมาจากผลของการเครียดที่เกิดจากความแตกต่างของค่าคงตัวผลึก รวมถึงคุณสมบัติของ Auger Recombination ที่เกิดขึ้นในเนื้อผลึก InGaAs ที่ทำให้คุณสมบัติการเปล่งแสงของผลึก InGaAs นี้มีค่าต่ำมาก จนไม่สามารถวัดได้

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## **Abstract**

In this work, the growth of InGaAs layers on GaAs substrates by molecular beam epitaxy (MBE) was investigated. The surface morphology of InGaAs layers on GaAs substrates was mirror-like. The surface morphology were characterized by surface roughness using atomic force microscope (AFM). The effect of growth temperature and V/III ratios on the properties of InGaAs epi-layers were studied. The undoped InGaAs layers showed n-type conduction behavior with a background carrier concentration of  $1.68 \times 10^{16}$ - $4.48 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$  and mobility of  $700$ - $1,791 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ . Both were measured by van der PAUW method at room temperature. These results showed a strong dependence of InGaAs epi-layer quality on the growth conditions such as growth temperature and  $\text{As}_4/(\text{In}+\text{Ga})$  flux ratios. The growth temperature is in the range of  $440$ - $480 \text{ }^\circ\text{C}$  and the  $\text{As}_4$  pressure in the range of  $3.3 \times 10^{-6}$ - $1.5 \times 10^{-5} \text{ torr}$ . The photoluminescence of samples can not be obtained because the lattice mismatched is induced by the strained in InGaAs epi-layers and Auger recombination.

## สารบัญ

หน้า

กิตติกรรมประกาศ.....	II
บทคัดย่อภาษาไทย.....	III
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	IV
สารบัญ.....	V
สารบัญตาราง.....	VI
สารบัญรูป.....	IX
สารบัญสัญลักษณ์.....	X
บทที่ 1 บทนำ.....	1
บทที่ 2 ความรู้พื้นฐาน.....	4
2.1 การปลูกผลึกอิพิเทกซ์จากคำโน้มเลกุล.....	4
2.1.1 ชุดระบบการปลูกผลึกอิพิเทกซ์จากคำโน้มเลกุล.....	4
2.1.2 Effusion cell.....	7
2.1.2.1 Knudsen cell .....	7
2.1.2.2 Cracker cell .....	9
2.1.2.3 Valved cracker cell.....	10
2.1.2.4 Gas injection cell.....	11
2.1.3 อุปกรณ์วิเคราะห์ .....	12
2.1.3.1 Reflection high energy diffraction electron (RHEED) .....	13
2.1.3.2 Residual gas analyzer.....	15
2.1.3.3 อุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถติดตั้งเข้าในระบบ MBE.....	15
2.2 กลไกการเกิดผลึกของการปลูกผลึกอิพิเทกซ์ MBE.....	16
2.3 สารประกอบกึ่งด้วนนำกลุ่ม III-V.....	19
2.3.1 โครงสร้างของสารประกอบกึ่งด้วนนำกลุ่ม III-V.....	19
2.3.2 คุณสมบัติของสารประกอบกึ่งด้วนนำกลุ่ม III-V.....	21
2.4 การวัดไฟฟ้าโคลมินาเซนซ์.....	22
2.5 การวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าวิชี van der PAUW.....	23
2.5.1 ปรากฏการณ์ฮอลล์ (Hall Effect) .....	24
2.5.2 วิธีการวัดของ van der PAUW .....	25

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.5.3 การวัด van der PAUW ในทางปฏิบัติ.....	29
2.5.3.1 การกำหนดนิยามการวัดค่าความต้านทาน.....	30
2.5.3.2 การวัดหาค่าสภาพต้านทาน.....	30
2.5.3.3 การกำหนดนิยามในการวัดหาค่าแรงดันช็อลด์.....	31
2.5.3.4 การวัดค่าแรงดันช็อลด์.....	32
บทที่ 3 การออกแบบการทดลอง.....	34
3.1 การเตรียมตัวอย่าง.....	34
3.2 การวิเคราะห์ตัวอย่าง.....	36
บทที่ 4 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผล .....	37
4.1 การตรวจสอบค่าความหนาของชั้นผลึก InGaAs ที่ได้.....	37
4.2 ผลการวัดผลด้วย X-RAY .....	39
4.3 ผลการวัด Surface morphology ด้วย AFM.....	41
4.4 ผลการวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าด้วยวิธี van der PAUW.....	43
4.5 ผลการวัดไฟโตลูมิเนสเซนซ์.....	47
บทที่ 5 สรุป.....	48
บทที่ 6 ข้อเสนอแนะ .....	49
เอกสารอ้างอิง.....	50

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1	ภาพโครงสร้างชุดระบบ MBE ของ RIBER รุ่น 32 P.....	6
รูปที่ 2.2	ชุดระบบ MBE ที่ติดตั้งที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.....	6
รูปที่ 2.3	แผนภาพโครงสร้าง Knudsen cell.....	7
รูปที่ 2.4	ภาพโครงสร้างของ Ga-trapping cap.....	9
รูปที่ 2.5	ภาพของโครงสร้าง Cracker cell.....	10
รูปที่ 2.6	ภาพของ Arsenic valve cracker cell.....	11
รูปที่ 2.7	ภาพโครงสร้างของ Effusion cell ชนิด Gas injector cell.....	12
รูปที่ 2.8	แผนภาพอธิบายกลไกการเปลี่ยนแปลงความเข้มของอิเล็กตรอน ในขณะทำการปลูกผลึก.....	14
รูปที่ 2.9	แผนภาพความสัมพันธ์ของรูปแบบ RHEED และอุณหภูมิของแผ่นผลึกฐาน (100) GaAs, InP และ InAs ภายใต้ไอของ Dimer.....	15
รูปที่ 2.10	ปฏิกริยาของการเกิดผลึก GaAs ในกรณี Ga-As <sub>2</sub> -(100) GaAs.....	18
รูปที่ 2.11	ปฏิกริยาของการเกิดผลึก GaAs ในกรณี Ga-As <sub>4</sub> -(100) GaAs.....	19
รูปที่ 2.12	แผนภาพโครงสร้างแบบ Zincblende.....	20
รูปที่ 2.13	แผนภาพจำลองการคูคูกลีนแสงและการเปล่งแสงที่เกิดจากการรวมตัว.....	23
รูปที่ 2.14	แผนภาพระบบการวัดไฟโอลูมิเนเซนซ์.....	24
รูปที่ 2.15	แผนภาพปรากฏการซอลล์.....	25
รูปที่ 2.16	ภาพโครงสร้างของตัวอย่างสำหรับการวัดหาค่าคุณสมบัติทางไฟฟ้าวิธี van der PAUW.....	27
รูปที่ 2.17	แผนภาพการวัดค่าสภาพด้านท่านในวิธีการวัดของ van der PAUW.....	28
รูปที่ 2.18	แผนภาพการวัดหาค่าแรงดันซอลล์ในวิธีการวัดของ van der PAUW.....	29
รูปที่ 3.1	แผนภาพโครงสร้างของตัวอย่างที่สร้างขึ้นในการทดลอง.....	34
รูปที่ 3.2	แผนภาพจำลองกระบวนการทำงานของการตั้งค่าอุณหภูมิและ Shutter ในการวิจัยนี้.....	35
รูปที่ 4.1	ภาพภาคตัดขวางของตัวอย่างชั้นผลึกอิพเทกซ์ InGaAs ที่ปลูกบนแผ่นผลึกฐาน (100) GaAs.38	
รูปที่ 4.2	ตัวอย่างスペกตรัมของผลการวัด XRD ที่ได้จากตัวอย่าง (ก) InP บน GaAs และ (ข) InGaAs บน GaAs ( $T_s = 460^\circ\text{C}$ , As <sub>4</sub> = $5.3 \times 10^{-6}$ torr).40	
รูปที่ 4.3	ภาพ AFM ขนาด $5 \times 5 \mu\text{m}^2$ ของตัวอย่างบางตัวอย่างและภาพแสดงภาคตัดขวางของผิวตามแนวเส้น翰ของในแต่ละภาพ.....	42
รูปที่ 4.4	กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Surface roughness และค่า BEP As <sub>4</sub> .....	43

## สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

- รูปที่ 4.5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้นพาหะ ค่าความกล่องตัวและค่าความดันไอ  $\text{As}_4$   
ภายใต้เงื่อนไขการปฏิกริยาที่อุณหภูมิแผ่นผลึกฐาน  $440\text{ }^{\circ}\text{C}$ .....44
- รูปที่ 4.6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้นพาหะ ค่าความกล่องตัวและค่าความดันไอ  $\text{As}_4$   
ภายใต้เงื่อนไขการปฏิกริยาที่อุณหภูมิแผ่นผลึกฐาน  $460\text{ }^{\circ}\text{C}$ .....45
- รูปที่ 4.7 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้นพาหะ ค่าความกล่องตัวและค่าความดันไอ  $\text{As}_4$   
ภายใต้เงื่อนไขการปฏิกริยาที่อุณหภูมิแผ่นผลึกฐาน  $480\text{ }^{\circ}\text{C}$ .....46

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 2.1	ตารางเปรียบเทียบชนิดของ Effusion cell และชนิดของลำไส้โมเลกุลที่ได้ จากวัตถุคืนนิคต่างๆ.....	12
ตารางที่ 2.2	รายการส่วนประกอบพื้นฐานใน Growth chamber ของระบบ MBE.....	16
ตารางที่ 2.3	อุณหภูมิจุดเหล็ดของสารประกอบ III-V ชนิดต่างๆ.....	17
ตารางที่ 2.4	ค่าแปร稼ยกาพของสารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V ชนิด 2 ชาตุ.....	21
ตารางที่ 2.5	ค่าແຄນพลังงานของตัวอย่างสารประกอบชนิด 3 ชาตุและ 4 ชาตุ.....	22
ตารางที่ 3.1	รายละเอียดของเงื่อนไขที่ใช้ในการปั๊กผลึก InGaAs ( $E_g \approx 0.75$ eV) บนแผ่นผลึกฐาน GaAs.....	35
ตารางที่ 4.1	ค่า $\Delta\theta$ ที่ได้จากการวัด XRD ของชั้นผลึก InGaAs ที่ปั๊กบนแผ่นผลึกฐาน GaAs.....	41
ตารางที่ 4.2	ค่าความเข้มข้นพาราเบลมาตรวัดความคล่องตัวพาราเบลมาตรวัดของตัวอย่างจากการปั๊กผลึก ที่อุณหภูมิ 440-480 °C.....	46

# สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญสัญลักษณ์

AlAs	: Aluminium Arsenide
AlP	: Aluminium Phosphide
AlSb	: Aluminium Antimonide
AlInAs	: Aluminium Indium Arsenide
AlGaInAs	: Aluminium Gallium Indium Arsenide
<i>d</i>	Thickness
<i>E<sub>g</sub></i>	Bandgap Energy
GaAs	: Gallium Arsenide
GaP	: Gallium Phosphide
GaSb	: Gallium Antimonide
GaInAsP	: Gallium Indium Arsenide Phosphide
InAs	: Indium Arsenide
InP	: Indium Phosphide
InSb	: Indium Antimonide
MBE	: Molecular Beam Epitaxy
MOCVD	: Metal-Organic Chemical Vapor Deposition
$\mu$	: Carrier mobility
<i>N<sub>d</sub></i>	: Electron Concentration
RHEED	: Reflection High Energy Electron Diffraction
UHV	: Ultra-high vacuum

## บทที่ 1

### บทนำ

ระบบสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสงระยะไกลในยานค่าความยาวคลื่น 1.5 ไมครอนต้องการสิ่งประดิษฐ์อปโ啼อิเล็กทรอนิกส์ที่ตอบสนองแสงในยานค่าความยาวคลื่นดังกล่าว [1-2] ซึ่งสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ส่วนใหญ่ประดิษฐ์ขึ้นจากสารประกอบกลุ่ม III-V ได้แก่ InGaAsP [3], InAlGaAs [4] และ AlGaAsSb [5] โดยผลึกของสารประกอบเหล่านี้มีค่าคงตัวผลึก (Lattice constant) มีค่าเท่ากับค่าคงตัวผลึกของสารประกอบ InP ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้แผ่นผลึกฐานเริ่มต้น InP ในกระบวนการประดิษฐ์อันเป็นผลทำให้สิ่งประดิษฐ์สำหรับการสื่อสารทางแสงในยานค่าความยาวคลื่น 1.5 ไมครอนจึงมีราคาแพงอันเนื่องมาจากการแผ่นผลึกฐานเริ่มต้น InP นั้นมีราคาแพง แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการปลูกผลึกอิพเทกซ์ที่ทำให้เราสามารถปลูกผลึกอิพเทกซ์ที่มีค่าคงตัวผลึกแตกต่างไปจากค่าคงตัวผลึกของแผ่นผลึกฐานเริ่มต้น (Lattice mismatched) ที่ทำให้เราสามารถประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่มีโครงสร้างเป็นผลึกที่มีค่าคงตัวผลึกแตกต่างไปจากค่าของแผ่นผลึกฐานเริ่มต้นได้ โดยคุณภาพของผลึกอิพเทกซ์ในโครงสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ได้นั้นขึ้นกับเงื่อนไขของการปลูกผลึกอิพเทกซ์ ได้แก่ ค่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะทำการปลูกผลึก (Substrate temperature) ค่าอัตราการปลูกผลึก (Growth rate) และค่าอัตราส่วนของ V/III (V/III ratio) เป็นต้น ในปัจจุบันแผ่นผลึกฐานเริ่มต้นที่นิยมใช้ในกระบวนการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์อปโ啼อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ GaAs และ InP แต่เมื่อพิจารณาในด้านราคาแล้วแผ่นผลึกฐานเริ่มต้น GaAs มีข้อดีที่เหนือกว่า และในด้านเทคโนโลยีการผลิตแผ่นผลึกฐานเริ่มต้น GaAs นั้นสามารถผลิตได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่ถึง 15 เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าของ InP ที่สามารถผลิตได้เพียงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตรอันเป็นผลทำให้ราคาสิ่งประดิษฐ์ต่อหน่วยมีราคาที่ถูกกว่า และอีกประการหนึ่งคือเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงที่ประดิษฐ์บนแผ่นผลึกฐานเริ่มต้น GaAs ได้ถูกพัฒนาจนมีขีดความสามารถในการผลิตออกจำนวนมากภายในเชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ได้แก่ ทราบชิสเทอร์ ความถี่สูงในโทรศัพท์ไร้สาย เครื่องรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ผ่านดาวเทียม เป็นต้น ดังนั้นหากเราสามารถประดิษฐ์แพร่วงจรรวมที่ประกอบขึ้นด้วยสิ่งประดิษฐ์อปโ啼อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานในยาน 1.5 ไมครอนรวมเข้ากับสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงได้ อันเป็นผลทำให้ราคาสิ่งประดิษฐ์มีราคาถูกลง มีความคล่องตัวในการใช้งานและความเป็นไปได้ในการผลิตออกจำนวนมากภายในเชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีของ GaAs ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

สำหรับสารประกอบ InGaAsP, InAlGaAs และ AlGaAsSb นั้น InAlGaAs เป็นกولي่สสารประกอบหนึ่งที่มีข้อดีเหนือกว่า InGaAsP และ AlGaAsSb ในด้านที่มีธาตุหมู่ V ตามในตารางธาตุเพียงชนิดเดียว อันทำให้การควบคุมค่าสัดส่วนประกอบอื่นๆ ที่เป็นธาตุหมู่ III ตามในตารางธาตุสามารถทำได้ง่ายกว่า เนื่องจากค่าสัดส่วนของธาตุหมู่ III มีความสัมพันธ์ในสภาวะไอและในสภาวะของแข็งนั้นมีความสัมพันธ์

ในแบบเชิงเส้น อีกประการหนึ่งคือความเป็นไปได้ในการใช้แผ่นผลึกฐานเริ่มต้น GaAs ซึ่งเป็นสารประกอบ As-based เห็นเดียวกันกับ InAlGaAs ทำให้กระบวนการปัจกผลึกสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง และการปรับเปลี่ยนค่าสัดส่วนของค่าสัดส่วนของ InAlGaAs สามารถทำได้ง่ายกว่า อันเนื่องมาจากตัวแปรสำหรับสารประกอบกลุ่มนี้เป็นธาตุหมู่ III ตามในตารางธาตุทั้งหมด ซึ่งสามารถควบคุมค่าสัดส่วนได้ง่ายกว่า สาเหตุจากค่าสัดส่วนของธาตุหมู่ III ตามในตารางธาตุมีความสัมพันธ์ในสภาวะไอและในสภาวะของแข็ง มีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้น แต่ในกรณีของธาตุหมู่ V ตามในตารางธาตุนั้นมีความสัมพันธ์แบบไม่เป็นเชิงเส้น ซึ่งทำให้การควบคุมค่าสัดส่วนในการผลิตทำได้ยากกว่า

สำหรับสารประกอบ InAlGaAs นั้นเป็นสารประกอบที่ประกอบขึ้นจากสารประกอบชนิด 3 ธาตุ (Ternary) จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ InGaAs ( $E_g \approx 0.75$  eV) และ InAlAs ( $E_g \approx 1.45$  eV) ซึ่งคุณสมบัติเชิงแสงของสารประกอบ InAlGaAs จะแปรเปลี่ยนไปตามค่าสัดส่วนของ InGaAs และ InAlAs ในสารประกอบดังกล่าว ดังนี้เราจึงสามารถประดิษฐ์หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์อป托อิเล็กทรอนิกส์ได้จากสารประกอบนี้ ทว่าการปรับเปลี่ยนค่าสัดส่วนของชั้นผลึกอิพเทกซ์ในโครงสร้างของสิ่งประดิษฐ์ โดยเฉพาะสารประกอบ InGaAs นั้นมีบทบาทสำคัญอย่างมากในสิ่งประดิษฐ์อป托อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานในย่านค่าความยาวคลื่น 1.5 ไมครอนทั้งสิ่งประดิษฐ์ปลั่งแสง (Light emitter) [6-7] และสิ่งประดิษฐ์ตรวจรับแสง (Light detector) [8-9] รวมถึง InGaAs ( $E_g \approx 0.75$  eV) มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับใช้ในการสร้างขั้วต่อ ไอหัมมิกที่มีค่าความด้านงานค่า [10] ดังนั้นสารประกอบ InGaAs ( $E_g \approx 0.75$  eV) จึงมีบทบาทสำคัญสำหรับสิ่งประดิษฐ์อป托อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานในย่านค่าความยาวคลื่น 1.5 ไมครอน

วิธีการปัจกผลึกอิพเทกซ์ที่นิยมใช้ในการผลิตเชิงพาณิชย์สำหรับ InGaAs ( $E_g \approx 0.75$  eV) ได้แก่ วิธีการปัจกผลึกอิพเทกซ์จากลำไไมเลกุล (Molecular beam epitaxy : MBE) และวิธีการปัจกผลึกอิพเทกซ์จากสถานะไอของโลหะ-อินทรีย์ (Metal-organic Vapor Phase Epitax : MOVPE) ในปัจจุบันกระบวนการผลิตสิ่งประดิษฐ์อปโตอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสื้อสารทางแสงในย่านค่าความยาวคลื่น 1.5 ไมครอน ในเชิงพาณิชย์นั้น ส่วนใหญ่ยังคงใช้แผ่นผลึกฐานเริ่มต้นจาก InP แต่ยังไร์ก์ตามได้มีนักวิจัยบางกลุ่มได้พยายามประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์อปโตอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ในการสื้อสารทางแสงในย่านค่าความยาวคลื่น 1.5 ไมครอน โดยใช้แผ่นผลึกฐานเริ่มต้น GaAs และใช้เทคนิคการปัจกผลึกอิพเทกซ์จากลำไไมเลกุล อันเนื่องมาจากการมีความปลอดภัยสูงและความแม่นยำในการกระบวนการผลิตสูง [11]

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมทางด้านองค์ความรู้ (Knowhow) สำหรับวัสดุสารประกอบกึ่งตัวนำ InGaAs ( $E_g \approx 0.75$  eV) คงจะผู้วิจัยจึงคำนึงถึงโครงการวิจัยนี้เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับการวิจัยสิ่งประดิษฐ์อปโตอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสื้อสารทางแสงในย่านค่าความยาวคลื่น 1.5 ไมครอน และการพัฒนาศักยภาพในการใช้ชุดระบบการปัจกผลึกอิพเทกซ์จากลำไไมเลกุลในการสังเคราะห์สารประกอบ

InGaAs ( $E_g \approx 0.75$  eV) เพื่อรองรับการพัฒนาและการวิจัยในด้านเลเซอร์ไดโอดและตัวตรวจรับแสง หรือโฟโตเดกเตอร์สำหรับระบบสื่อสารทางแสงระยะไกลต่อไป

สำหรับรายงานวิจัยนี้มีเนื้อหาสาระดังนี้ ในบทที่ 2 กล่าวถึงความรู้พื้นฐานของการปลูกพลักอิพิแทกซ์จากลำไไม่เลกุล ได้แก่ รายละเอียดของโครงสร้างชุดระบบการปลูกพลักอิพิแทกซ์จากลำไไม่เลกุล กลไกการเกิดพลักในการปลูกพลักอิพิแทกซ์จากลำไไม่เลกุล ความรู้พื้นฐานของสารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V การวัดคุณสมบัติเชิงไฟฟ้าวิธี van de PAUW ในบทที่ 3 กล่าวถึงรายละเอียดและขั้นตอนการทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและค่าอัตราส่วน BEP ของ  $As_x/(In+Ga)$  ที่มีต่อคุณสมบัติของพลัก InGaAs ที่ปลูกบนแผ่นพลักฐาน GaAs ในบทที่ 4 กล่าวถึงผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลองที่ได้ ในบทที่ 5 เป็นการสรุปผลการทดลอง และในบทที่ 6 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยนี้และแนวทางในการพัฒนาเพื่อนำผลการทดลองที่ได้ไปใช้งานต่อไป

# สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 2 ความรู้พื้นฐาน

สำหรับในบทนี้เป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้โดยสังเขป ซึ่งมีเนื้อหาสาระ เกี่ยวข้องกับเทคนิคการปลูกผลึกอิพเทกซ์จากลำไบโนเลกุล (Molecular Beam Epitaxy : MBE) กลไกการเกิด ผลึกที่เกิดขึ้นในกระบวนการปลูกผลึกอิพเทกซ์วิธี MBE ความรู้พื้นฐานของสารประกอบกึ่งตัวนำกุ่ม III-V การวัดไฟฟ้าoluminescence (Photoluminescence) และการวัดคุณสมบัติเชิงไฟฟ้าวิธี Van der Pauw

### 2.1 การปลูกผลึกอิพเทกซ์จากลำไบโนเลกุล (Molecular Beam Epitaxy : MBE)

การปลูกผลึกอิพเทกซ์จากลำไบโนเลกุลหรือ MBE เป็นเทคนิคการปลูกชั้นผลึกสารประกอบกึ่งตัวนำ บนผิวของแผ่นผลึกฐาน (Substrate) ที่เป็นผลึกเดียว (Single Crystal) โดยการพ่นลำไบโนเลกุลของก้าช หรืออะตอมของธาตุที่เป็นวัตถุคุบลงบนผิวน้ำแผ่นผลึกฐาน ซึ่งเกิดปฏิกิริยาระหว่างโนเลกุลหรือ อะตอมที่เป็นองค์ประกอบของสารประกอบสารกึ่งตัวนำ โนเลกุลเหล่านี้ได้จากการระเหยหรือระเหด (Evaporation) วัสดุที่มีธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารประกอบ (Constituent species) ภายใต้สภาวะ สุญญากาศระดับสูงพิเศษ (Ultra-high Vacuum) ปฏิกิริยาของการเกิดเป็นสารประกอบนี้เกิดขึ้นที่ผิวน้ำ ของแผ่นผลึกฐาน ค่าอัตราส่วนของสารประกอบและคุณสมบัติทางภาพของชั้นผลึกอิพเทกซ์ที่ปลูก ได้นั้นขึ้นกับเงื่อนไขและตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการปลูกผลึก ได้แก่ อัตราส่วนค่าความดัน ไอของลำไบโนเลกุล ที่เป็นองค์ประกอบ อุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะทำการปลูก ฯลฯ เป็นต้น นอกจากนี้อัตราการปลูกผลึก นี้ขึ้นค่าความดัน ไอขององค์ประกอบที่มีคุณสมบัติการเกาะติด (Impinging) ผิวน้ำแผ่นผลึกฐาน สำหรับ ข้อดีของการปลูกผลึกอิพเทกซ์วิธี MBE ได้แก่ การเตรียมผิวแผ่นผลึกฐานสามารถทำได้ง่าย โดยวิธีการ ทำความสะอาดด้วยความร้อน (Thermal cleaning) ภายใต้สภาวะสุญญากาศ ความสามารถในการตรวจสอบ (Monitoring) โครงสร้างผิว (Surface structure) ที่สามารถกระทำได้ตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นการปลูก ผลึกจนถึงสุดกระบวนการปลูกผลึก นอกจากนี้การปลูกผลึกอิพเทกซ์วิธี MBE ที่ดำเนินการในระบบ สุญญากาศระดับสูงพิเศษ ทำให้ผลึกที่ปลูกได้นั้นมีความบริสุทธิ์สูงกว่าวิธีการอื่นๆ เนื่องจากก้าชต่างๆ ที่ มีผลกระทบต่อคุณภาพผลึก ได้แก่  $H_2O$ ,  $O_2$ ,  $CO$  และ  $CO_2$  เป็นต้น มีปริมาณที่ค่อนข้างมาก ในสภาวะ สุญญากาศระดับสูงพิเศษ จึงให้ความสามารถควบคุมคุณภาพของผลึกได้ตามที่เราต้องการ

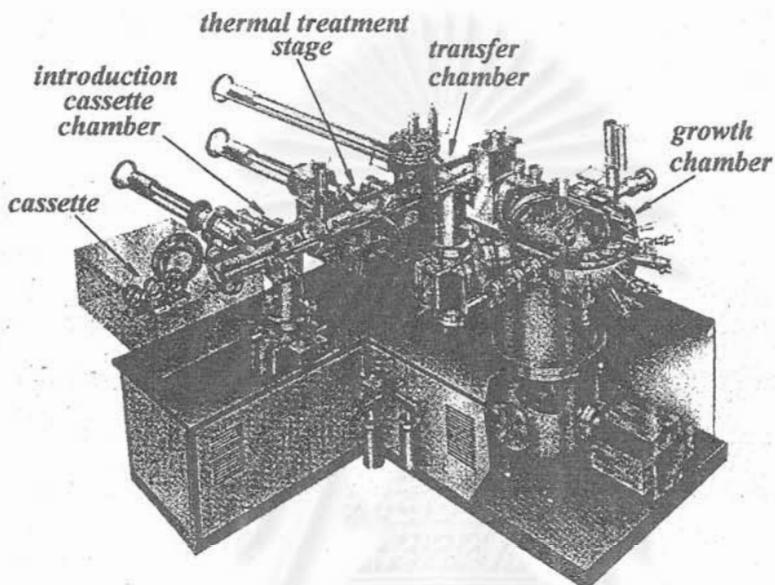
#### 2.1.1 ชุดระบบการปลูกผลึกอิพเทกซ์จากลำไบโนเลกุล

ชุดระบบการปลูกผลึกอิพเทกซ์จากลำไบโนเลกุลที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นชุดระบบ MBE ของบริษัท RIBER รุ่น 32 P ซึ่งมีลักษณะเป็นโมดูล (Module) โดยประกอบด้วยส่วน Introduction chamber ส่วน

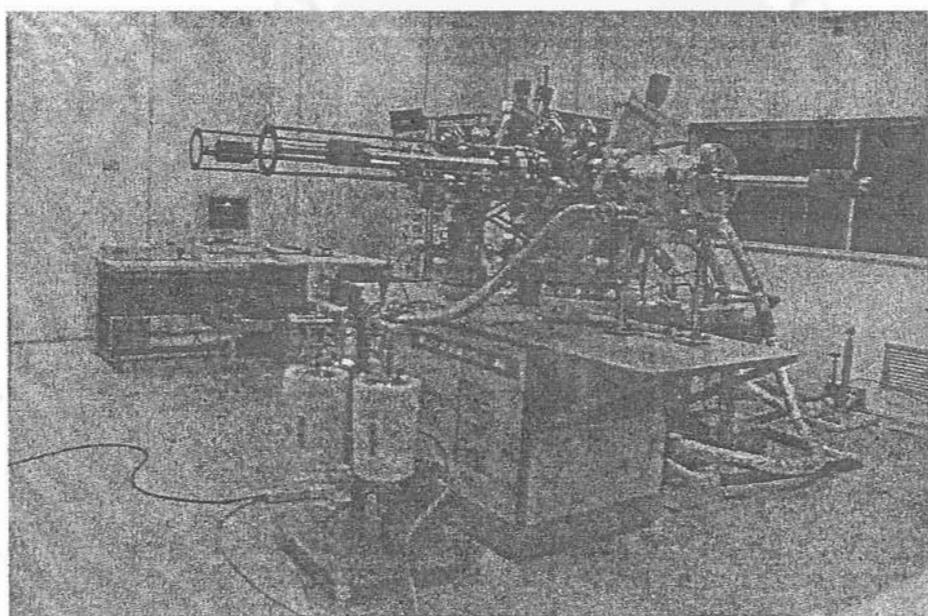
Thermal treatment stage ส่วน Transfer buffer chamber และส่วน Growth chamber ดังแผนภาพตามรูปที่ 2.1 โดยดูดแต่ละส่วนที่ต้องกันนี้มี Gate valve ต่อขึ้นกลางระหว่างโมดูล โดยจะเปิด Gate valve ให้ Cassette ที่เป็น Carrier ในการบรรทุก Substrate holder ผ่านเข้าออกจากโมดูลส่วนหนึ่งไปยังโมดูลอีกส่วนหนึ่ง และเพื่อปิดแยกให้โมดูลแต่ละส่วนเป็นอิสระจากกัน เพื่อให้การรักษาสภาวะสุญญากาศในแต่ละส่วนเป็นอิสระจากกัน ส่วน Introduction chamber เป็นส่วนติดต่อระหว่างภายนอกที่มีสภาวะความดันบรรยายกาศปกติ (760 torr) และส่วน Thermal treatment stage ซึ่งมีสภาวะสุญญากาศในระดับ  $10^{-10}$  torr โดยส่วน Introduction chamber นี้มีปั๊มสุญญากาศ (Vacuum pump) จำนวน 2 ชุดคือ Rotary pump และ Sorption pump ทำหน้าที่ปั๊มปืนเพื่อสร้างสภาวะสุญญากาศระดับปานกลาง ( $10^{-4}$  Torr) โดย Cassette จากภายนอกสามารถล้ำเลียงผ่านโมดูลส่วนนี้ เพื่อล้ำเลียงเข้าสู่ระบบ MBE ต่อไป ในทำนองกลับกันการล้ำเลียง Cassette ออกจากระบบ MBE ก็ดำเนินการผ่านส่วน Introduction chamber เช่นเดียวกัน และทำการปรับสภาวะจากสุญญากาศสู่สภาวะบรรยายกาศปกติด้วยการเติมก๊าซในโถเรนทะอัด ส่วน Thermal treatment stage เป็นส่วนที่ใช้ในการทำ Outgassing แผ่นผลึกฐานก่อนการปลูกผลึก เพื่อໄล์ความชื้นและจัดออกไซด์ (บางส่วน) ที่ผิวของแผ่นผลึกฐาน ในส่วนนี้มีปั๊มสุญญากาศจำนวน 2 ชุดคือ Ion pump และ Ti sublimation pump ส่วน Transfer buffer chamber เป็นส่วนที่ใช้ในการล้ำเลียง Substrate holder เข้าหรือออกจากส่วน Growth chamber และส่วน Growth chamber เป็นส่วนที่กระบวนการปลูกผลึกอิพิแทกซ์ดำเนินการในโมดูลส่วนนี้ โดยแผนภาพของส่วน Growth chamber ดังรูปที่ 2.1 ส่วนประกอบต่างๆ มีดังนี้ ส่วน Cyopanel เป็นช่องเปิดสำหรับรับในโถเรนเหลวจากภายนอก เพื่อทำหน้าที่หล่อเย็น ระยะความร้อนที่เกิดจาก Effusion cell ให้แก่ Growth chamber นอกจากนี้ในโถเรนเหลวยังช่วยทำให้สภาวะสุญญากาศในส่วน Growth chamber ดีขึ้น เนื่องจากความเย็นของในโถเรนเหลวทำให้มวลของบรรยายกาศภายในมีความหนาแน่นมากขึ้น ทำให้ระบบปั๊มสุญญากาศสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น สำหรับวัตถุคิบิที่ใช้ในระบบของคณะผู้วิจัย ได้แก่ Ga, Al, In, As, P (ได้จากการศ라이ต์ของ GaP ใน Knudsen cell ที่มี Ga-trapping Cap) และ Si (สารเจือปนชนิดเอ็น : n-type Dopant).

นอกจากนี้ในส่วน Growth chamber ยังมีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ชุด Reflection high energy electron diffraction หรือ RHEED, Gas analyzer หรือ Quadupole mass spectrometry และ Ionization gauge เป็นอุปกรณ์หลักพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อระบบ MBE โดย RHEED นี้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบโครงสร้างผิว นอกจากนี้ RHEED ยังสามารถใช้ในการควบคุมค่าความหนาของชั้นผลึกที่ปลูกได้จากปรากฏการณ์ RHEED intensity oscillation ที่เกิดขึ้นในเทคนิค Phase-locked epitaxy หรือ PLE [12] และ Migration enhanced epitaxy หรือ MEE [13] ที่สามารถควบคุมค่าความหนาได้ในระดับ Monolayer ของผลึกที่ปลูก ส่วน Gas analyzer เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบสภาวะบรรยายกาศภายใน Growth chamber และ Ionization gauge เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดเทียบค่าความดันไอขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการปลูกผลึกแต่ละครั้ง เพื่อปรับแต่งเงื่อนไขค่าความดันไอขององค์ประกอบต่างๆ ในการปลูกผลึกแต่ละครั้งให้

ได้เงื่อนไขตามที่ต้องการ ในปัจจุบันระบบ MBE ได้มีการพัฒนาให้สามารถได้อุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจากนี้ สำหรับใช้ในการวิเคราะห์คุณสมบัติของผลึกเข้าไปในระบบ MBE ได้แก่ Ellipsometer ที่ใช้ในการควบคุมค่าความหนา (Thickness) ซึ่งทำให้เกิดความคล่องตัวและความต่อเนื่องในการทำงาน ขั้นช่วยให้สามารถควบคุมการปลูกผลึก การวิเคราะห์โครงสร้างและคุณสมบัติของผลึกที่ปลูกได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินการสามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว



รูปที่ 2.1 ภาพโครงสร้างชุดระบบ MBE ของ RIBER รุ่น 32 P



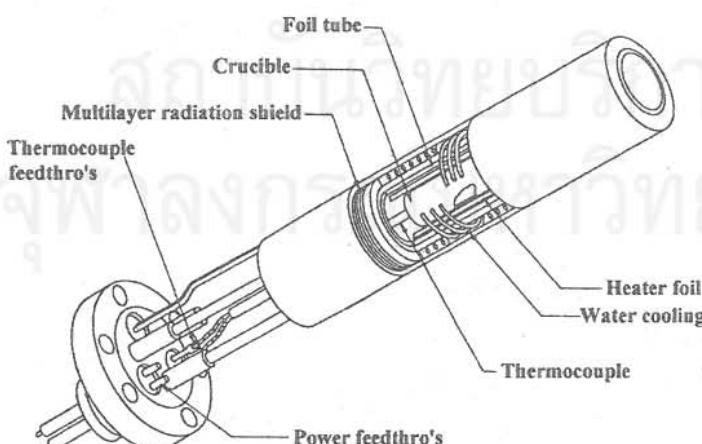
รูปที่ 2.2 ชุดระบบ MBE ที่ติดตั้งในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### 2.1.2 Effusion cell

Effusion cell เป็นอุปกรณ์หลักสำคัญของระบบ MBE ในการผลิตสำโนเลกุลขององค์ประกอบจากวัตถุคิบที่ใช้ในการปลูกผลึก ซึ่งวัตถุคิบนี้เป็นธาตุบริสุทธิ์หรือสารประกอบที่มีธาตุที่เป็นองค์ประกอบที่ได้ และความสำคัญของ Effusion cell นั้นเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้การปลูกผลึกวิธี MBE มีข้อดีเด่นที่เหนือกว่าเทคนิคอื่นๆ โดย Effusion cell แต่ละชนิดนั้นมีความเหมาะสมสำหรับวัสดุแต่ละชนิดแตกต่างกันไป ซึ่งในรายงานวิจัยนี้นำเสนอเฉพาะ Effusion cell ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกผลึกอิเล็กทรอนิกส์ของ GaAs และ InP เท่านั้น

#### 2.1.2.1 Knudsen cell

Knudsen cell หรือ K-cell เป็น Effusion cell แบบที่ง่ายที่สุด ซึ่งใช้ในการระเหยหรือระเหิด (Evaporate) วัตถุคิบให้เป็นสำโนเลกุลด้วยพลังงานความร้อน สำหรับโครงสร้างของ Knudsen Cell ดังในรูปที่ 2.3 วัตถุคิบที่ใช้กุญแจรูไว้ในเบ้าหลอม (Crucible) ซึ่งทำจากวัสดุ Pyrolytic boron nitride หรือ PBN โดยเบ้าหลอมนี้ถูกคล้องรอบด้วยคดลวดความร้อน (Heating elements) ชุดลวดความร้อนเป็นตัวกำเนิดความร้อนให้แก่เบ้าหลอมจากการผ่านกระแสไฟฟ้า และที่ได้เบ้าหลอมนี้มีเทอร์โมคัปเปอร์ (Thermocouple) ติดตั้งอยู่ เพื่อใช้ในการตรวจสอบอุณหภูมิและการควบคุมค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในชุดลวดความร้อน ให้ได้อุณหภูมิตามที่ต้องการ โดยอาศัยสัญญาณจากเทอร์โมคัปเปอร์ต่อเข้ากับเครื่องควบคุมแบบ PID ที่ทำหน้าที่ควบคุมแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ป้อนให้ชุดลวดความร้อนของ Effusion cell เพื่อทำให้เบ้าหลอมมีอุณหภูมิตามที่กำหนด สำหรับ K-cell ที่มีเบ้าหลอมขนาดใหญ่นั้นจำเป็นต้องมีท่อน้ำร้ายความร้อนอยู่ภายใน เพื่อให้ความร้อนที่เกิดขึ้นไม่ไปรบกวนส่วนอื่นๆ อีกด้วย



รูปที่ 2.3 แผนภาพโครงสร้าง Knudsen Cell

สำหรับการควบคุมปริมาณของจำนวนโมเลกุลที่พ่นออกจาก Knudsen cell ควบคุมได้จาก อุณหภูมิของชุดความร้อนภายใน Knudsen cell ซึ่งปริมาณของจำนวนโมเลกุลของสารที่พ่นออกจาก Knudsen cell สามารถคำนวณได้จากสมการ

$$J = 1.118 \times 10^{22} \frac{pA}{l^2 \sqrt{MT}} \quad \text{molecules/cm}^2 \cdot \text{s} \quad (2.1)$$

โดย  $p$  คือค่าความดันไอของธาตุที่อุณหภูมิกำหนดมีหน่วยเป็น托orr (Torr)

$A$  คือพื้นที่บริเวณปากช่องเปิดของ Knudsen Cell (Cell orifice area) มีหน่วยเป็น ตร. ซม.

$l$  คือระยะห่างจากปากช่องเปิดของ Knudsen Cell ถึงผิวน้ำของผลึกฐานมีหน่วยเป็น ซม.

$M$  คือค่ามวลโมเลกุลขององค์ประกอบที่เป็นวัตถุคืนมีหน่วยเป็น AMU

$T$  คือค่าอุณหภูมิของศาสสมบูรณ์ของกําชนาะบรรจุใน Knudsen Cell มีหน่วยเป็นเคลวิน (K)

สำหรับค่าอัตราการเกิดผลึก (Growth rate) ของการปักกีวิธี MBE สำหรับสารประกอบกลุ่ม III-V นี้ขึ้นกับจำนวนโมเลกุลของธาตุหมู่ III เช่นกรณีของ GaAs ขั้นตอนการเกิดผลึกสามารถคำนวณได้จาก สมการ

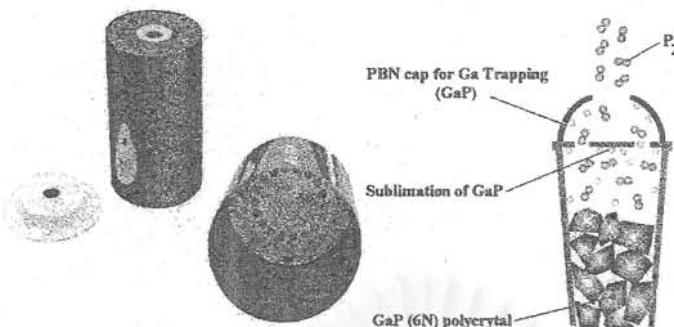
$$R = \alpha J_{Ga} \quad (2.2)$$

โดย  $R$  คืออัตราการเกิดผลึกมีหน่วยเป็น ไมโครน/ชั่วโมง

$\alpha$  คือค่าคงตัว (Constant) ซึ่งค่าคงตัวนี้ขึ้นกับค่าอุณหภูมิแผ่นผลึก

และทิศทางผิวน้ำของแผ่นผลึกฐาน (Substrate orientation)

กลไกการเกิดผลึกของสารประกอบกลุ่ม III-V นั้นถูกกำหนดโดยอะตอมของธาตุหมู่ III ในสภาวะของกําชที่ถูกพ่นไปยังผิวน้ำของผลึกแผ่นฐานเป็นหลัก อันเนื่องมาจากการอะตอมของธาตุหมู่ III มีค่าสัมประสิทธิ์การเกาะติด (Sticky coefficient) สูงกว่าอะตอมของธาตุหมู่ V โดยกลไกการเกิดผลึกนี้ กับอัตราการพ่นของธาตุ III จาก K-cell ที่เกาะลงบนผิวน้ำของแผ่นผลึกฐาน จากนั้นจะจับรวมตัวทางเคมี กับอะตอมของธาตุหมู่ V ในรูปของสารประกอบ และเรียงตัวกันเป็นผลึกตามโครงสร้างของแผ่นผลึกฐาน ตัวอย่างเช่น In-As ที่ได้จากคำแนะนำของ In และ As<sub>4</sub> หรือ As<sub>2</sub> และ Ga-As ที่ได้จากคำแนะนำของ Ga และ As<sub>4</sub> หรือ As<sub>2</sub> ทำปฏิกิริยาที่ผิวน้ำของผลึกแผ่นฐาน แล้วจึงก่อให้เกิดพันธะเข็นเป็นโครงผลึกที่มีลักษณะเช่นเดียวกับของแผ่นผลึกฐาน โดยกระบวนการเกิดผลึกนี้ขึ้นกับพลังงานกระตุ้นที่ให้แก่โมเลกุล เหล่านี้ ได้แก่ ความร้อนจากอุณหภูมิของผลึกแผ่นฐานและพลังงานesonที่ได้จาก Knudsen cell



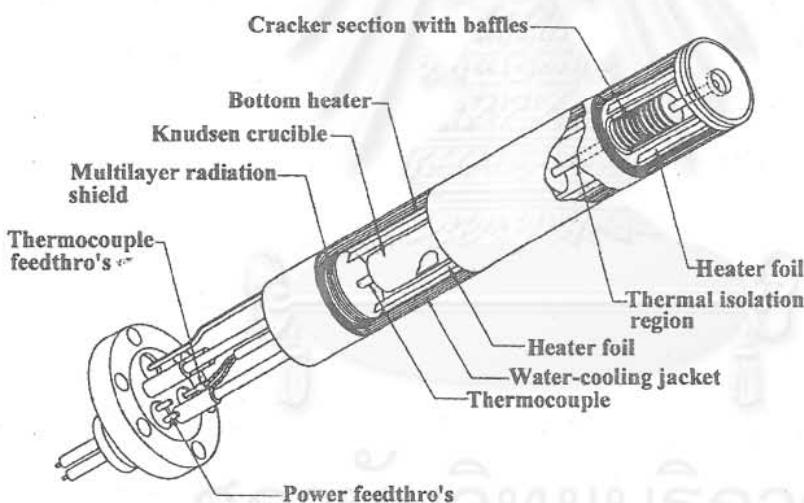
Gallium Trapping Cap System

รูปที่ 2.4 ภาพโครงสร้างของ Ga-trapping cap [14]

อย่างไรก็ตาม Knudsen cell นั้นมีจุดสำคัญคือสำหรับสารหรือธาตุบางชนิด เนื่องจากไม่เหมาะสมสำหรับในการผลิตลำไส้เล็กๆ ของสารหรือธาตุที่มีความดันไอสูงได้ ด้วยอย่างเช่น P, S, Se เป็นต้น เนื่องจากการควบคุมค่าความดันไอทำได้ยาก ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนา Knudsen Cell ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ได้แก่ Valved cracker cell สำหรับสารเหล่านี้ แต่อย่างไรก็ได้ Valved cracker cell นั้นมีราคาแพงและโครงสร้างซับซ้อน สำหรับสิ่งประดิษฐ์อีกชนิดหนึ่งที่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับ Knudsen cell แบบธรรมดานี้ เพื่อใช้ในการผลิตลำไส้เล็กชนิด Dimer ของ As ( $As_2$ ) และ P ( $P_2$ ) ได้แก่ Ga-trapping cap วัสดุคือที่ใช้ในการนี้เป็นสารประกอบ GaAs และ GaP เนื่องจากมีราคาถูกและอุณหภูมิของการถ่ายตัวมีค่าไม่สูงเกินไป และค่าความแตกต่างของค่าความดันไอของ Ga และสารประกอบในสภาวะสมดุลที่มีค่าต่ำกว่าไอของ  $As_2$  หรือ  $P_2$  ที่อุณหภูมิเดียวกัน โดยอุณหภูมนี้มีค่าสูงกว่าค่าอุณหภูมิจุดเหลวของสารประกอบ Ga-trapping cap นั้นทำหน้าที่กักไอของสารประกอบ GaP ไว้ภายในภาชนะหรือ Crucible ของ Knudsen cell โดย Ga-trapping cap ช่วยในการรักษาสภาวะสมดุลของไอในสภาวะที่เกิดกลไกการถ่ายตัว (Decomposition) ของสารประกอบ สำหรับการถ่ายตัวของสารประกอบดังกล่าวมีเกิดขึ้นจากพลังงานความร้อนหรือการทำให้สารประกอบอยู่ในสภาวะอุณหภูมิสูง ซึ่งในสภาวะสมดุลนี้สารประกอบกลุ่ม III-V มีจำนวนหรือปริมาณของอะตอมธาตุหมู่ III จำนวนมากกว่าธาตุหมู่ V และในสภาวะอุณหภูมิสูงนี้ธาตุหมู่ V อยู่ในรูปของ Dimer ( $V_2$ ) เป็นส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากค่าความดันไอของไม่เล็กๆ ของหมู่ V นั้นมีค่าสูงกว่า จึงทำให้ไม่เล็กๆ ของ Dimer ที่เกิดขึ้นถูกพ่นออกมามีเป็นไม่เล็กๆ เพียงอย่างเดียว โครงสร้างของ Ga-trapping cap ดังในรูปที่ 2.4

### 2.1.2.2 Cracker cell

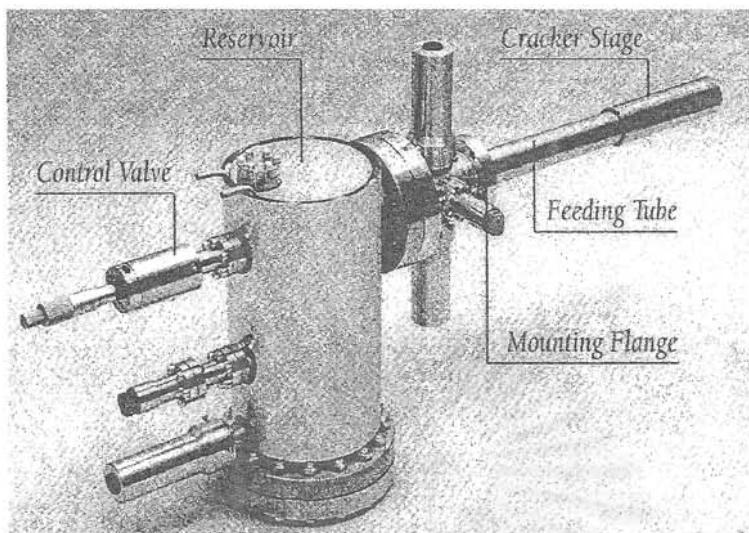
Cracker cell มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Dissociation cell เป็น Effusion cell ที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นแหล่งกำเนิดลำโมเลกุลของธาตุหมู่ V ชนิด Dimer ( $V_2$ ) ซึ่งตามปกติลำโมเลกุลของธาตุหมู่ V ที่ได้จาก Effusion cell ตามปกติเป็นชนิด Tetramer ( $V_4$ ) (ด้วยย่าง เช่น As มี  $As_2$  เป็นโมเลกุล Dimer และ  $As_4$  เป็นโมเลกุล Tetramer) โดยสร้างของ Cracker cell มีลักษณะคล้ายคลึงกับ Knudsen cell แต่ Cracker cell นั้นมี Cracking zone ซึ่งเป็นส่วนของชุดความร้อนที่ให้อุณหภูมิสูงในช่วง 800-1000°C เพื่อทำให้โมเลกุล Tetramer แตกตัวเป็นโมเลกุล Dimer และในการออกแบบนั้นมีข้อควรระวังคือต้องให้ส่วน Cracking zone อยู่ห่างจาก Crucible หรือ Reservoir ที่บรรจุตุคบมากเพียงพอ เพื่อมิให้ความร้อนจาก Cracking zone ซึ่งมีค่าอุณหภูมิสูงรบกวนส่วน Crucible อันมีผลต่อการควบคุมค่าความดันໄอोได้ ดังนั้น Effusion cell ชนิดนี้จึงมีความยากกว่า Knudsen Cell และจำเป็นต้องมีส่วนของท่อน้ำหรือส่วนระบบความร้อนในลักษณะอื่นๆ สำหรับทำหน้าที่เป็นระบบบรรยายความร้อน (Cooling) เพื่อให้การควบคุมอุณหภูมิในส่วน Crucible สามารถทำได้



รูปที่ 2.5 ภาพโครงสร้างของ Cracker Cell

### 2.1.2.3 Valved cracker cell

Valved cracker cell เป็น Effusion cell ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแหล่งกำเนิดลำโมเลกุลชนิด Dimer ของธาตุหมู่ V ซึ่ง Valved cracker cell มีกลไกของ Nozzle valve ที่ใช้ในการควบคุมค่าความดัน จากการปรับตำแหน่งของ Valve รวมถึงความสามารถในการปิดกั้นໄอิไว้ภายใน Reservoir เพื่อไม่ให้

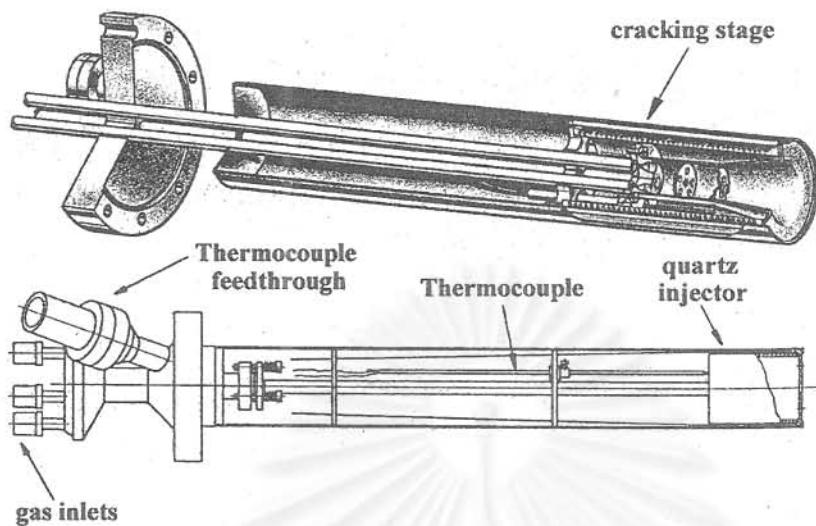


รูปที่ 2.6 ภาพของ Arsenic Valve Cracker Cell [15]

ไออุกมาได้ในสภาวะที่เรามีความต้องการ ทำให้มีความคล่องตัวในการกำหนดค่าความดัน ไอตามเงื่อนไขได้ง่ายและความสามารถในการตัดลำไบเลกุลได้ดีกว่า Effusion cell ชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะการปลูกพลังของโครงสร้างเชเทโร (Heterostructure) ที่มีสารประกอบของชาตุหมู่ V ที่ต่างชนิดกัน ข้อดีของ Valved cracker cell คือสามารถใช้วัตถุดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแตกต่างจาก Knudsen cell และ Valved cracker cell ซึ่งวัตถุดินภายในนั้นถูกทำให้กลایเป็นไโอระเหิดออกมาตรฐานเวลา ถึงแม้ว่า Shutter อยู่ในตำแหน่งปิดก็ตาม

#### 2.1.2.4 Gas injector cell

Gas injector cell เป็น Effusion cell ที่ใช้ก๊าซเป็นวัตถุดิน ซึ่งอยู่ในรูปของ Hydride สำหรับแหล่งจ่ายชาตุหมู่ V เช่น PH<sub>3</sub>, AsH<sub>3</sub>, และ Organic compound สำหรับแหล่งจ่ายชาตุหมู่ III ตัวอย่างได้แก่ TMGa และ TMIn เป็นต้น โดยโครงสร้างของ Gas injector cell มีลักษณะคล้ายคลึงกับ Knudsen cell ต่างกันแต่ด้วยความร้อนที่ใช้นั้นมีอุณหภูมิสูงกว่า เพื่อให้ก๊าซที่ไหลผ่านแตกตัวออกเป็นโมเลกุลแบบ Dimer หรือ Tetramer สำหรับโมเลกุลชาตุหมู่ V และจะ-domเดียวสำหรับชาตุหมู่ III นั้นสามารถควบคุมได้จากค่าอุณหภูมิในส่วน Cracking zone สำหรับข้อดีของการใช้ก๊าซเป็นวัตถุดินคือความต่อเนื่องและความสะดวกในการเติมก๊าซวัตถุดิน โดยไม่มีความจำเป็นในการทำให้ระบบร้าวก่อนการเติมวัตถุดินเหมือนระบบ MBE ทั่วๆ ไป เนื่องจากวัตถุดินนั้นถูกเก็บไว้ในท่อ ก๊าซที่ต่อเข้าระบบ MBE ซึ่งสามารถปิดท่อของระบบการป้อนก๊าซที่ต่อเข้าระบบและทำการเปลี่ยนท่อ ก๊าซได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อสภาวะสุญญากาศของ Growth chamber แต่อย่างไรก็ตามการใช้ก๊าซเป็นวัตถุดินนั้นมีความจำเป็นที่ต้องติดตั้งระบบปั๊มสูญญากาศที่มีขนาดกำลังสูงเพียงพอและต้องเป็นปั๊มปืนนิดที่คงทนต่อการกัดกร่อนของก๊าซเหล่านั้น



รูปที่ 2.7 ภาพโครงสร้างของ Effusion cell ชนิด Gas injector Cell [16]

คุณภาพของคำโน้มเลกุลที่ได้จาก Effusion cell นั้นมีผลต่อคุณภาพและความสม่ำเสมอของผลึก ดังนั้นคำโน้มเลกุลที่ได้นั้นต้องมีเสถียรภาพ (Stable) ความสม่ำเสมอ ความสะอาดขององค์ประกอบต่างๆ ของ Effusion cell และความบริสุทธิ์ของวัตถุคิบที่ใช้ก็มีส่วนสำคัญต่อคุณภาพของคำโน้มเลกุล คำโน้มเลกุลชนิดต่างๆ ของธาตุหมู่ V และชนิด Effusion cell และวัตถุคิบที่ใช้สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ตารางเปรียบเทียบชนิด Effusion cell และชนิดของคำโน้มเลกุลที่ได้จากวัตถุคิบชนิดต่างๆ

Effusion Cell	ชนิดของคำโน้มเลกุล				
	P <sub>2</sub>	As <sub>2</sub>	As <sub>4</sub>	Sb <sub>2</sub>	Sb <sub>4</sub>
Knudsen cell	GaP	GaAs	Solid As	Solid Sb	Solid Sb
Cracking cell	Solid P	Solid As	Solid As	Soild Sb	Soild Sb
Valved cracking cell	Solid P	Solid As	Solid As	Soild Sb	Soild Sb
Gas injector cell	PH <sub>3</sub>	AsH <sub>3</sub>	-----	SbH <sub>3</sub>	-----

## 2.1.3 อุปกรณ์วิเคราะห์

ข้อเด่นของระบบ MBE ที่เหนือกว่าวิธีการปั๊กผลึกอิพิแท็คชีวิชื่อain ในเชิงเทคนิคก็คือสามารถติดตั้งอุปกรณ์วิเคราะห์ต่างๆ เข้ากับระบบได้ ทำให้มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบและวิเคราะห์และมีความสะดวก ซึ่งหมายความสำหรับการวิจัยและการผลิตเชิงพาณิชย์ สำหรับในรายงานนี้ขอกล่าวถึงโดยสังเขปเฉพาะอุปกรณ์วิเคราะห์หลักที่เป็นสำหรับระบบ MBE ที่านี้

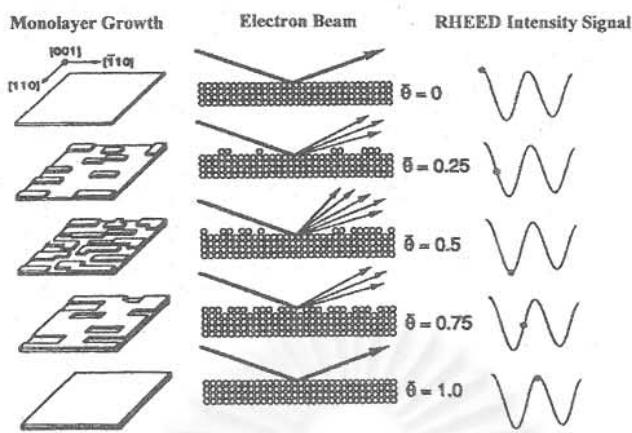
### 2.1.3.1 Reflection high energy electron diffraction (RHEED)

RHEED เป็นเครื่องมือหลักที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างผิว (Surface Structure) โดยข้อมูลที่ได้จาก RHEED นี้บ่งบอกรูปแบบของลักษณะโครงสร้างผิวในเชิง Microstructure และความเรียบของผิว (Smoothness) ซึ่งลักษณะรูปแบบ (Pattern) ที่ได้จาก RHEED นี้ขึ้นกับลักษณะการเรียงตัวของอะตอมในโครงสร้างผลึกและความเรียบของผิวที่ทำให้ลำอิเล็กตรอนเบี่ยงเบน (Diffraction) ไปในลักษณะ 3 มิติ ทำให้รูปแบบของ RHEED ที่ปรากฏขึ้นแตกต่างกันไป

สำหรับหน้าที่หลักสำคัญของ RHEED ที่สรุปได้มีดังนี้

1. การตรวจสอบผิวน้ำแผ่นผลึกฐานในขณะที่ทำความสะอาดด้วยความร้อน (Thermal Cleaning) ก่อนการปั๊กผลึก
2. การควบคุมสภาพเริ่มต้นของการปั๊กผลึก
3. การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผิวในขณะที่ทำการปั๊กผลึก

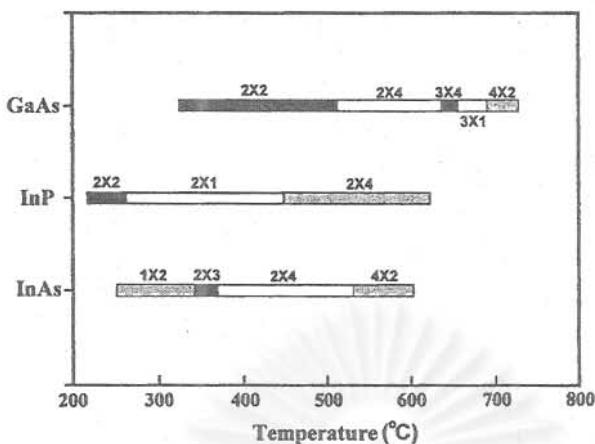
นอกจากนี้ RHEED ยังสามารถใช้ในการสอนเทียบค่าอัตราการปั๊กผลึก (Growth rate calibration) ได้ เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มแสง RHEED ในขณะที่ทำการปั๊กผลึก ซึ่งสามารถอธิบายได้ตามรูปที่ 2.8 ตามปกติผิวน้ำของผลึกก่อนการปั๊กผลึกมีความเรียบ ทำให้อิเล็กตรอนสามารถสะท้อนผ่านผิวน้ำผลึกที่มีอะตอมเรียงตัวเป็นระเบียบ ซึ่งความเข้มของอิเล็กตรอนที่สะท้อนผ่านไปในกรณีนี้ค่าความเข้มสูงสุด แต่เมื่อการปั๊กผลึกเริ่มต้นขึ้นการเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มแสง RHEED มีค่าลดลงในขณะที่ทำการปั๊กผลึกนี้เกิดจากการกระเจิง (Scattering) ของลำอิเล็กตรอน อันเนื่องจากผลึกที่เกิดขึ้นนั้นบนผิวน้ำของแผ่นผลึกเกิดการเรียงตัวของก้อนผลึกขนาดเล็ก (Cluster) โดยก้อนผลึกขนาดเล็กที่เกิดขึ้นนั้นมีลักษณะกระჯัดกระจาดไม่เป็นระเบียบ อันเป็นผลทำให้ความเข้มของลำอิเล็กตรอนมีค่าลดลง จนกระทั่งพื้นที่ของก้อนผลึกขนาดเล็กเหล่านั้นคลุมผิวน้ำของผลึกมากกว่าครึ่งหนึ่ง ความเข้ม



รูปที่ 2.8 แผนภาพอธิบายกลไกการเปลี่ยนแปลงความเข้มของอิเล็กตรอนในขณะทำการปัจกผลึก

แสงของ RHEED จะกลับมาเมื่อความเข้มเพิ่มขึ้นอีก จนมีค่าสูงสุดเมื่อผลึกเรียงเต็มผิวน้ำแผ่นผลึกฐาน ซึ่งความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของความเข้มและค่าความหนาของผลึกที่เกิดขึ้นนี้มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบคลื่นรูปไซน์ (Sine) โดยการเปลี่ยนแปลงค่าความเข้มหนึ่งรอบในการเปลี่ยนแปลงความหนาหนึ่งชั้น โนเลกุล (Monolayer) ด้วยเหตุนี้เองทำให้สามารถควบคุมค่าความหนาของชั้นผลึกที่ได้ในระดับชั้น โนเลกุล โดย RHEED เป็นเครื่องมือสำคัญในเทคนิค PLE และ MEE ซึ่งเป็นนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นเทคนิคสำคัญในการสร้างโครงสร้าง Quantum Dot แต่อย่างไรก็เดือนอนิมีข้อจำกัดคือการเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มแรงไม่ชัดเจนในการปัจกผลึกของสารประกอบบางชนิด และการเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มแรง RHEED นั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขในสภาวะที่แตกต่างกันอีกด้วย สำหรับรายละเอียดต่างๆ จะขอไม่กล่าวถึงในที่นี้

นอกจากนี้รูปแบบ (Pattern) ของ RHEED ที่ได้ของผลึกแต่ละชนิดสามารถบ่งบอกถึงช่วงค่าอุณหภูมิของผิวน้ำผลึกได้ด้วยดังตัวอย่างในรูปที่ 2.9 ซึ่งปัจจุบันยังนิยมใช้วิธีนี้ในการตรวจสอบอุณหภูมิผิวน้ำของแผ่นผลึกฐานในการปัจกผลึกวิธี MBE และสามารถใช้ได้กับสารประกอบเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะสารประกอบกึ่งตัวนำที่ค่าແผลงงานมีค่าน้อยมาก อันเป็นข้อดีที่เหนือกว่าวิธีการวัดด้วย Pyrometer ซึ่งไม่สามารถใช้ได้ในกรณีนี้ [17] แต่อย่างไรก็เดียวการนี้มีความคลาดเคลื่อนมากกว่า  $10^{\circ}\text{C}$  และมีความผุ่งยากในการอ่านรูปแบบของ RHEED ในการวัดเทียบอุณหภูมิ โดยขึ้นกับความชำนาญของผู้อ่านเป็นอย่างมาก



รูปที่ 2.9 แผนภาพความสัมพันธ์ของรูปแบบ RHEED และอุณหภูมิของแผ่นผลึก (100) GaAs, InP และ InAs ภายใต้ไอของ Dimer [18]

### 2.1.3.2 Residual gas analyzer

Residual gas analyzer หรือ Quadupole mass spectrometer เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของอนุภาคที่เป็นก้าชภายในส่วน Growth chamber ซึ่งทำให้เราสามารถรู้สภาพบรรยายภายในส่วน Growth chamber นอกจากนี้ Residual gas analyzer ยังสามารถใช้วิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบ (Composition) ของสารประกอบในขณะที่ทำการปลูกผลึกได้ เช่นกัน [19] โดยข้อดีของ Residual gas analyzer ที่เหนือกว่าการใช้ Ionization gauge ก็คือ Residual gas analyzer มีความละเอียดและความแม่นยำสูงกว่า อีกทั้งไม่มีผลของการเสื่อม (Degradation) ของความไว (Sensitivity) ในการวัด เช่นเดียวกับ Ionization gauge เมื่อใช้งานไประยะเวลานาน

### 2.1.3.3 อุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถติดตั้งเข้าในระบบ MBE

นอกจาก RHEED, Ionization gauge และ Residual gas analyzer ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักพื้นฐานที่ติดตั้งในส่วน Growth chamber ของระบบ MBE อุปกรณ์อื่นๆ ที่ติดตั้งเพื่อช่วยในการปลูกผลึกสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Pyrometer เพื่อใช้ในการวัดอุณหภูมิผิวน้ำแผ่นผลึกฐาน Ellipsometer เพื่อใช้ในการควบคุมค่าความหนาและค่าอัตราส่วนของสารประกอบได้แม่นยำยิ่งขึ้น ด้วยลักษณะของระบบ MBE ที่เป็นโมดูลที่มีสภาวะสุญญากาศระดับพิเศษทำให้สามารถต่อระบบ MBE เข้ากับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ ได้แก่ Auger electron spectroscopy (AES), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), Secondary ion

ตารางที่ 2.2 รายการส่วนประกอบพื้นฐานใน Growth chamber ของระบบ MBE

ส่วน (Facilities)	รายการเครื่องมือ (Component)	หน้าที่ (Function)
Beam Generators	Knudsen cell Cracker cell Valved cracker cell Gas injector cell	แหล่งจ่ายดำเนินและควบคุม
Beam Interruptors	Shutter	ทำหน้าที่เปิด-ปิดดำเนินและหักเม็ดพื้นสู่ผิวน้ำของแผ่นผลึกฐาน เพื่อใช้ในการควบคุมกระบวนการการปลูกผลึก
Beam and Growth Monitors	RHEED Quadupole mass spectrometer Ionization gauge	วิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างผิว ข้อมูลค่าความดันไอของดำเนินและค่าอัตราส่วน
Process Environment	Multichamber UHV system	ระบบ Multichamber ช่วยให้สามารถลดปริมาณของ residual gas ที่ active (ไดออกซิเจน $O_2$ , คาร์บอนไดออกไซด์ $CO_2$ , น้ำ $H_2O$ , ออกซิเจนตัวเดียว $C_2O$ ) ทำให้สามารถปลูกผลึกที่มีความบริสุทธิ์สูง

microscopic spectroscopy (SIMS), Scanning tunnelling microscope (STM) ได้อีกด้วย จึงทำให้เราสามารถวิเคราะห์สมบัติของผลึกได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยเฉพาะ STM เป็นเครื่องมือที่มีขีดความสามารถในการวิเคราะห์ที่ช่วยให้เราสามารถเข้าใจกลไกต่างๆ ในระดับขนาดของอะตอม [20] ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ของเครื่องมือเหล่านั้นสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารอื่นๆ สำหรับรายการของส่วนประกอบพื้นฐานใน Growth chamber สรุปไว้ในตารางที่ 2.2

## 2.2 กลไกการเกิดผลลัพธ์ของการปลูกผลึกอิพิแทกซ์วิชี MBE

กลไกการเกิดผลลัพธ์ของการปลูกผลึกอิพิแทกซ์จะจากคำไม้เล็กๆ สำหรับสารประกอบกึ่งตัวนำกุ่น III-V นั้นเกิดจากอะตอมของธาตุหมู่ III เป็นหลัก เนื่องจากความสามารถของการเกาะติดผิวแห่งผลึกฐานของธาตุหมู่ III ซึ่งตามปกติแล้วผิวน้ำของแผ่นผลึกฐานก่อนการปลูกถูกปอกลุมด้วยบรรยายกาศของไม้เล็กๆ ของธาตุหมู่ V เพื่อชดเชยการสูญเสียในขณะที่แผ่นผลึกฐานมีค่าอุณหภูมิสูง อันเป็นผลทำให้ผิวน้ำแห่งผลึกฐานเป็นชั้นของอะตอม V ดังนั้นอะตอมของธาตุหมู่ III จึงเรียงตัวเกาะลงบนชั้นของอะตอม V จนคล้ายเป็นชั้นของอะตอม III จากนั้นอะตอมของธาตุหมู่ V ทำปฏิกิริยาเกาะบนอะตอมของธาตุหมู่ III หรือถูกดูดซับ (Adsorp) จากอะตอมของธาตุหมู่ III โดยลักษณะของการเรียงตัวของอะตอมของธาตุหมู่ III และ V นั้นเรียกว่าสลับกันไปคลอดการปลูกผลึก ซึ่งอะตอมของธาตุหมู่ V ได้จากการแตกตัวของไม้เล็กๆ ที่อยู่ในรูป Dimer หรือ Tetramer ทำให้กระบวนการเกิดผลึกเป็นลักษณะได้สัดส่วนตามโครงสร้าง (Stoichiometric) โดยไม้เล็กส่วนเกินของธาตุหมู่ V นั้นถูกปล่อยหายออก (Desorp) จากผิวน้ำของแผ่นผลึกฐาน แต่อย่างไรก็ตามค่าอุณหภูมิผิวน้ำของแผ่นผลึกฐานมีความสำคัญสำหรับการปลูกผลึกวิธีนี้ ดังนั้นหากอุณหภูมิผิวน้ำของแผ่นผลึกฐานมีค่าสูงทำให้เกิดผลดังต่อไปนี้

ก) ในกรณีที่อุณหภูมิผิวน้ำของแผ่นผลึกฐานมีค่าสูงกว่าจุดระเหิดของธาตุหมู่ V ทำให้เกิดการปล่อยกายอะตอมของธาตุหมู่ V ออกจากผิวแห่งผลึกฐาน

ข) ในกรณีที่อุณหภูมิผิวน้ำของแผ่นผลึกฐานมีค่าสูงขึ้นและมีค่าสูงกว่าจุดระเหิดของธาตุหมู่ III ทำให้เกิดการปล่อยกายอะตอมของธาตุหมู่ III ออกจากผิวแห่งผลึกฐาน

ตารางที่ 2.3 อุณหภูมิจุดระเหิดของสารประกอบ III-V ชนิดต่างๆ [21]

สารประกอบ	$T_{CS}$ (°C)	$T_{max(V4)}$ (°C)	$T_{max(V2)}$ (°C)	$J_{V4}/J_{III}$
AlP	>700	640	700	~1.0/1
GaP	670	490	750	~1.0/1
InP	363	>450	>500	~3.0/1
AlAs	>750	630	750	~1.5/1
GaAs	~620	480	>760	~1.0/1
InAs	~370	~450	~550	~5.0/1

$T_{CS}$  หมายถึงอุณหภูมิของการระเหิด (Congruent Sublimation Temperature)

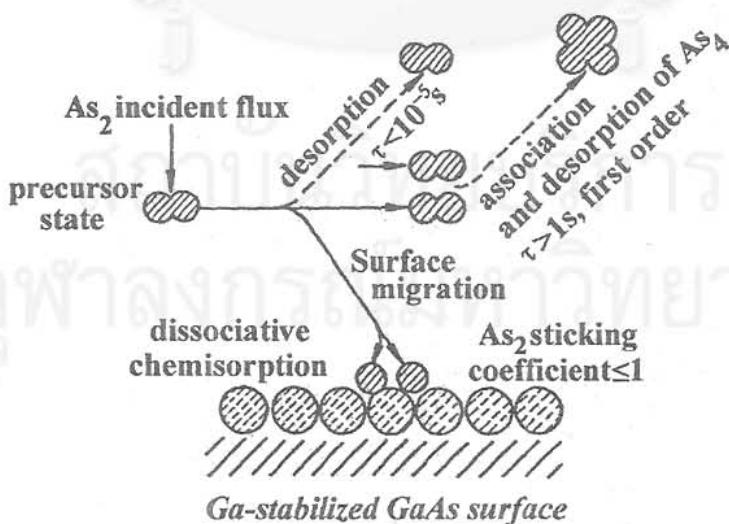
$T_{max}(V_4)$  หมายถึงอุณหภูมิสูงสุดภายใต้บรรยายกาศ tetramer ไม่เลกุลของธาตุหนู่ V

$T_{max}(V_2)$  หมายถึงอุณหภูมิสูงสุดภายใต้บรรยายกาศ dimer ไม่เลกุลของธาตุหนู่ V

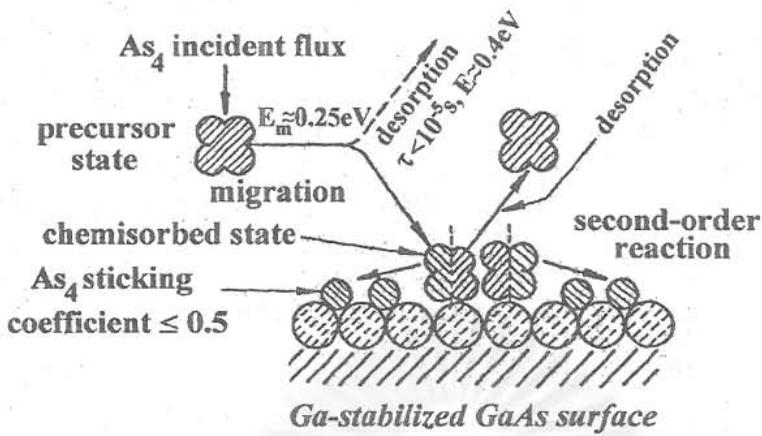
$J_{V4}/J_{III}$  หมายถึงค่าอัตราส่วน flux ของ V/III ที่เกิดจากการสลาย (Decomposition)

ดังนี้อุณหภูมิของแผ่นพลีกฐานเจ็กรอยู่ในระดับที่ไม่เกิดสารเหตุในข้อ a) จึงมีความจำเป็นที่ต้องทำการลดเชื้อละตอนธาตุของหนู่ V ที่สูญเสียไป เนื่องจากผลในข้อ g) ซึ่งค่าอุณหภูมิการระเหิดของสารประกอบชนิดต่างๆ มีค่าตามตารางที่ 2.3

การอธิบายปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในการปักกิจกรรมพิเศษซึ่งแตกต่างจากคำโน้มเลกุลนั้นเราสามารถใช้แบบจำลองตามรูปที่ 2.10 และ 2.11 ขึ้นเป็นตัวอย่างของ GaAs ซึ่งปฏิกิริยานั้นสามารถเกิดขึ้นได้ 2 กรณีคือกรณีของ Ga-As<sub>2</sub>-(100) GaAs และกรณีของ Ga-As<sub>4</sub>-(100) GaAs สำหรับในกรณี Ga-As<sub>2</sub>-(100) GaAs ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเริ่มต้นจากอะตอมของ Ga เกาะติดบนผิวน้ำของแผ่นพลีกฐานเรียงตัวเป็นชั้น (layer) จากนั้นไม่เลกุล As<sub>2</sub> ทำปฏิกิริยากับอะตอมของ Ga โดยแตกตัวเป็นอะตอม As และเกาะตัวบนชั้นอะตอม Ga สำหรับอัตราการเกาะของไม่เลกุล As<sub>2</sub> ที่ผิวน้ำแผ่นพลีกฐานขึ้นกับค่า Flux ของ Ga สำหรับไม่เลกุล As<sub>2</sub> ส่วนเกินนั้นจะระเหิดไปในรูปของไม่เลกุล As<sub>2</sub> และ As<sub>4</sub> ทำให้การเกิดพลีกเป็นแบบ Stoichiometric growth ดังในรูปที่ 2.10 สำหรับกรณี Ga-As<sub>4</sub>-(100) GaAs นั้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนกว่าโดยไม่เลกุล As<sub>4</sub> คุณนึงทำปฏิกิริยากับอะตอม Ga ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งอะตอม Ga ได้เกาะอยู่ที่ผิวน้ำของ



รูปที่ 2.10 ปฏิกิริยาของการเกิดพลีก GaAs ในกรณี Ga-As<sub>2</sub>-(100) GaAs



รูปที่ 2.11 ปฏิกิริยาของการเกิดผลึก GaAs ในกรณี Ga-As<sub>4</sub>-(100) GaAs

แผ่นผลึกฐาน ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากโมเลกุล As<sub>4</sub> แต่ละโมเลกุลแตกตัวให้อะตอม As จำนวน 2 อะตอม ลงบนผิวน้ำของแผ่นผลึกฐานด้วยการคุดซับจากอะตอมของ Ga โดยจำนวนอะตอมของ As ที่เกาะลงบนผิวน้ำมีสัดส่วนเทียบกับจำนวนอะตอมของ Ga ที่เกาะที่ผิวน้ำ ส่วนอะตอม As ส่วนที่เหลือจำนวน 4 อะตอมนี้จะรวมตัวกันเป็นโมเลกุล As<sub>4</sub> และถูกปล่อยหายออกจากผิวไป ดังนั้นในกรณีนี้จึงมีความจำเป็นที่ต้องให้ความหนาแน่นของโมเลกุล As<sub>4</sub> หรือ Flux ของ As<sub>4</sub> ( $J_{As_4}$ ) มีค่ามากกว่าความหนาแน่นของโมเลกุล Ga หรือ Flux ของ Ga ( $J_G$ ) เพื่อให้จำนวนโมเลกุล As<sub>4</sub> มีจำนวนมากเพียงพอสำหรับปฏิกิริยาที่มีส่วนที่เกาะเรียงตัวในผลึกและส่วนที่ปล่อยหายออก ในขณะที่ทำการปักผลึกนั้นอะตอมของ As สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนหนึ่งที่เกาะลงบนผิวของอะตอม Ga เรียงตัวเป็นโครงผลึก และอีกส่วนหนึ่งที่ถูกปล่อยหายออกมานั้น ซึ่งเป็นส่วนที่สูญเสียไปและการสูญเสียนี้มีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิผิวน้ำของแผ่นผลึกฐานมีค่าสูงขึ้น

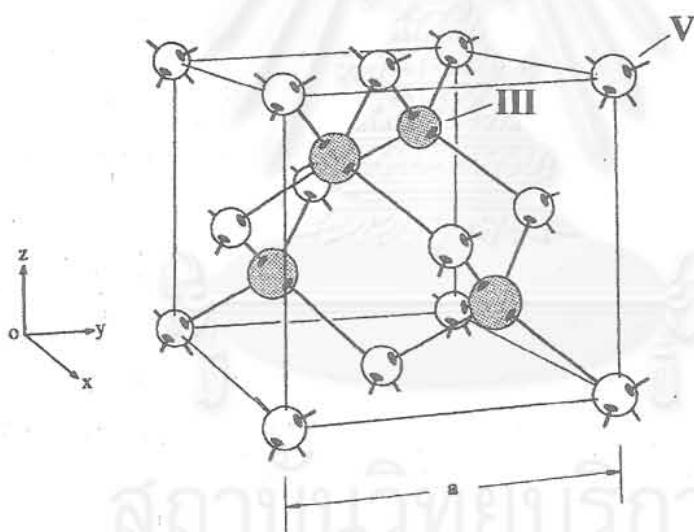
### 2.3 สารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V

นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 50 ได้มีการค้นพบสารประกอบกึ่งตัวนำชนิดสองชาติ (Binary) ของกลุ่ม III-V และคุณสมบัติต่างๆ ของสารประกอบเหล่านี้มีคุณสมบัติทางกายภาพที่หลากหลายตามชนิดและองค์ประกอบของสารประกอบ นับตั้งแต่ค่าช่องว่างแอนด์พัลลิงงาน (Energy gap) ในช่วง 0.18-2.42 eV ค่าดัชนีหักเห ฯลฯ เป็นต้น ต่อมาในทศวรรษที่ 60 ได้มีการพัฒนาวิธีการเตรียมของสารประกอบเหล่านี้เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ และเทคนิคการปักผลึกต่างๆ ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงนี้ การปักผลึกอิเล็กทรอนิกส์ในยุคนี้ส่วนใหญ่นั้นมีวัสดุประสงค์เพื่อการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ประมาณปี 1970 สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ GaAs เป็นสิ่งประดิษฐ์ของสารประกอบ III-V กลุ่มแรกที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นและ

สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นในยุคนี้เป็นต้นแบบของสิ่งประดิษฐ์ในยุคต่อมา โดยเฉพาะสิ่งประดิษฐ์สำหรับระบบสื่อสารทางแสงในช่วงย่าง 1.3 และ  $1.5 \mu\text{m}$  ที่สร้างจากสารประกอบ InGaAsP บนแผ่นผลีกฐาน InP ดังนั้นในหัวข้อนี้จะเป็นการบทพวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V

### 2.3.1 โครงสร้างของสารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V

สารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V มีโครงสร้างแบบ Zincblende ตามรูปที่ 2.12 ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับโครงผลีเพชร (Diamond) ได้แก่ ผลีเพชร ผลี Si และ ผลี Ge โดยการเรียงตัวของอะตอมของธาตุหมู่ III และ V เรียงตัวสลับกันเป็นชั้นๆ ไปตามทิศทาง (100) ในโครงผลี ซึ่งแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมในโครงสร้างนี้เป็นพันธะโคوالเอนท์ (Covalent bond) และระยะห่างระหว่างอะตอมนั้น ขึ้นกับขนาดของอะตอมที่มีประกอบกันเป็นสารประกอบในโครงผลี ดังนั้นตัวแปรอีกด้วยหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะของสารประกอบแต่ละชนิดคือ ค่าคงตัวผลี (Lattice constant :  $a$ ) ซึ่งสารประกอบแต่ละชนิดมีค่าแตกต่างกัน ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2.4



รูปที่ 2.12 แผนภาพโครงสร้างแบบ Zincblende

ตารางที่ 2.4 ตัวแปรทางกายภาพของสารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V ชนิด 2 ชาตุ [22]

สารประกอบ	ค่าคงตัวผลึก ( $\text{\AA}$ )	ค่าແດນพลังงาน (eV)	ชนิดของແດນพลังงาน
AlP	5.451	2.45	ແດນพลังงานໄມ່ຕຽງ
AlAs	5.6605	2.16	ແດນพลังงานໄມ່ຕຽງ
AlSb	6.1355	1.58	ແດນพลังงานໄມ່ຕຽງ
GaP	5.4512	2.26	ແດນพลังงานໄມ່ຕຽງ
GaAs	5.6533	1.42	ແດນพลังงานຕຽງ
GaSb	6.0959	0.72	ແດນพลังงานຕຽງ
InP	5.8686	1.35	ແດນพลังงานຕຽງ
InAs	6.0584	0.36	ແດນพลังงานຕຽງ
InSb	6.4794	0.17	ແດນพลังงานຕຽງ

### 2.3.2 สมบัติของสารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V

เนื่องจากสารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V นั้นมีคุณสมบัติที่หลากหลาย โดยขึ้นกับองค์ประกอบ และสัดส่วนปริมาณของชาตุที่ประกอบกันขึ้นเป็นสารประกอบ ตามปกติแผ่นผลึกฐานเริ่มต้นส่วนใหญ่ นั้นเป็นสารประกอบกึ่งตัวนำชนิด 2 ชาตุ (Binary) ซึ่งมีคุณสมบัติทางกายภาพเฉพาะตัว เนื่องจากตัวแปร ขององค์ประกอบมีจำนวนน้อยที่สุด ดังนั้นในการสร้างแผ่นผลึกฐานจึงนิยมทำจากสารประกอบ 2 ชาตุ แต่คุณสมบัติที่จำกัดของสารประกอบชนิด 2 ชาตุที่ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในบางกรณี ก็มีและ สำคัญคือสารประกอบชนิด 3 ชาตุและ 4 ชาตุ ได้ถูกนำมาใช้ในการสร้างหัวต่อเซทิโร (Heterojunction) โดย มีค่าคงตัวผลึกเข้าได้กับแผ่นผลึกฐาน เนื่องจากค่าແດນพลังงานหรือค่าดัชนีหักเหที่มีค่าแตกต่างกันไป อันเป็นผลทำให้มีความสะดวกในการออกแบบและประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์จากความสามารถในการ กำหนดวัสดุที่มีความเหมาะสมกับสิ่งประดิษฐ์ได้ สำหรับค่าตัวแปรต่างๆ ของสารประกอบกึ่งตัวนำตัว อย่างเดงแสดงในตารางที่ 2.4 และ 2.5

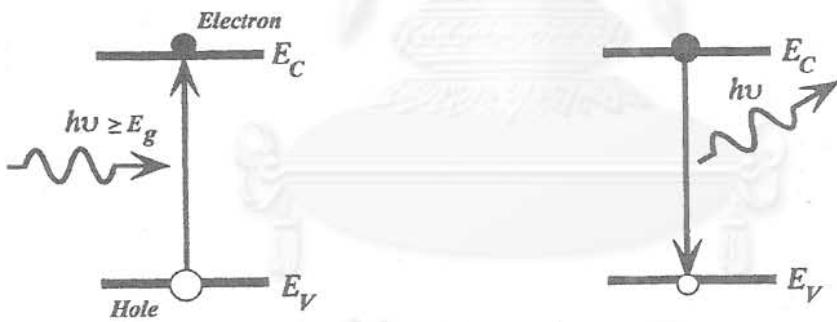
ตารางที่ 2.5 ค่าແຕบพลังงานของตัวอย่างสารประกอบชนิด 3 ชาตุและ 4 ชาตุ [23]

สารประกอบ	ค่าช่องว่างແນບพลังงาน (eV) ที่ 300 K	ค่าช่องว่างແນບพลังงาน (eV) ที่ 300 K ในกรณีที่ Matching กับ InP
<b>สารประกอบ 3 ชาตุ</b>		
Al <sub>x</sub> In <sub>1-x</sub> As	$E_g(\Gamma) = 0.36 + 2.35x + 0.24x^2$ $E_g(X) = 1.82 + 0.4x$	$E_g(\Gamma) = 1.45, x = 0.52$
Ga <sub>x</sub> In <sub>1-x</sub> As	$E_g(\Gamma) = 0.36 + 0.505x + 0.555x^2$	$E_g(\Gamma) = 0.75, x = 0.53$
GaAs <sub>1-x</sub> Sb <sub>x</sub>	$E_g(\Gamma) = 0.37 + 1.91x + 0.74x^2$	$E_g(\Gamma) = 0.78, x = 0.5$
<b>สารประกอบ 4 ชาตุ</b>		
Ga <sub>x</sub> In <sub>1-x</sub> As <sub>y</sub> P <sub>1-y</sub>	$E_g(\Gamma) = 1.35 + 0.668x - 1.068y + 0.758x^2$ $+ 0.078y^2 - 0.069xy - 0.322x^2y + 0.03xy^2$ $E_g(\Gamma) = 1.35 - 0.775y + 0.149x^2$	$x = 0.47y$ $E_g(\Gamma) = 13.5 - 0.775y + 0.149y^2$
Al <sub>x</sub> Ga <sub>y</sub> In <sub>1-x-y</sub> As	$E_g(\Gamma) = 0.36 + 2.093x + 0.629y + 0.577x^2$ $+ 0.436y^2 + 1.013xy - 2.0xy(1-x-y)$	$(In_{0.52}Al_{0.48})_z(In_{0.53}Ga_{0.47})_{1-z}As$ $x = 0.48z, 0.983x + y = 0.468$ $E_g(\Gamma) = 0.76 + 0.49z + 0.20z^2$

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## 2.4 การวัดโฟโตคูลมิเนสเซนซ์

การวัดโฟโตคูลมิเนสเซนซ์เป็นการวัดคุณสมบัติการเปลี่ยนแสงของสารกึ่งตัวนำจากการกระตุ้นด้วยแสงที่มีค่าพลังงานโฟตอนไม่น้อยกว่าค่าແນบพลังงาน (Energy band gap) ของสารกึ่งตัวนำ จากผลของการคุณลักษณะของสารกึ่งตัวนำทำให้เกิดพาราส่วนเกิน (Excess carrier) ขึ้น โดยในสภาวะปกติอิเล็กตรอนในແນบพลังงานวาราเคนซ์ (Valence band) เมื่อได้รับพลังงานกระตุ้นนี้หรือได้รับการถ่ายเทพลังงานจากโฟตอน ทำให้อิเล็กตรอนเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานไปสู่ແบนนำไฟฟ้า (Conduction band) ซึ่งเป็นสเตทที่มีระดับพลังงานที่สูงกว่าเดิม ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานของอิเล็กตรอนนี้ทำให้เกิดสเตทว่างหรือโอล (Hole) ขึ้นในແນบ瓦เคนซ์ ซึ่งอิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานที่สูงกว่าปกตินี้สามารถอยู่ในสภาวะดังกล่าวได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นอิเล็กตรอนและโอลหรือพาราส่วนเกินที่เกิดขึ้นจะรวมตัวกัน (Recombination) ซึ่งการรวมตัวนี้อิเล็กตรอนพยายามออกมายังรูปของโฟตอนที่มีค่าประมาณค่าແບนพลังงานหรือค่าระดับพลังงานที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อเราทำการวัดスペกตรัมของแสงที่ได้จากการเปลี่ยนแสงนี้จะทำให้เราทราบค่าແບนพลังงานของสารกึ่งตัวนำได้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานแบบ Band-to-impurity level เป็นต้น นอกจากนี้การวัดโฟโตคูลมิเนสเซนซ์ยังสามารถใช้ในการวัดคุณสมบัติของโครงสร้างความต้านทานด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งรายละเอียดจะไม่ขอกล่าวถึงในที่นี้



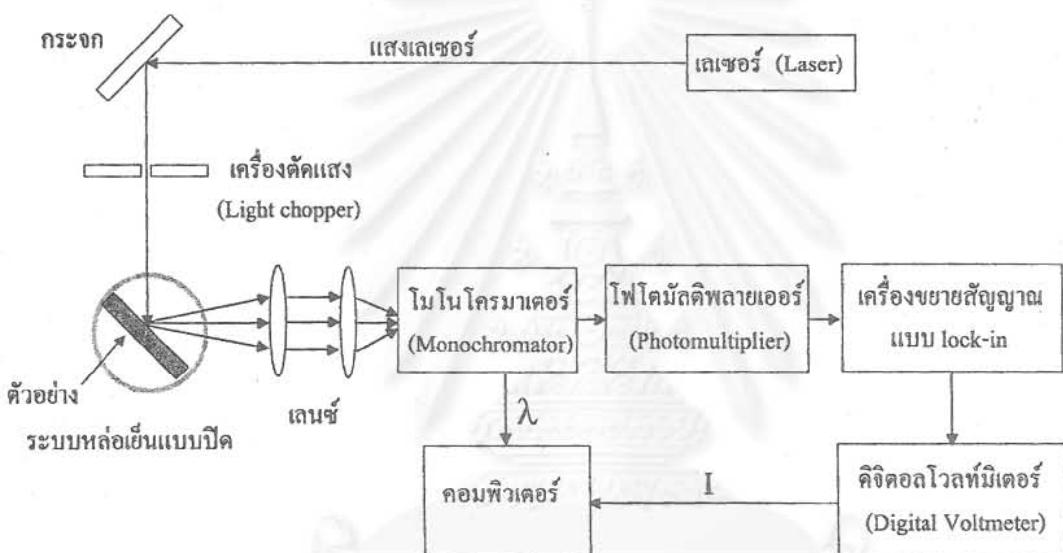
(ก) การคุณลักษณะแสง

(ข) การเปลี่ยนแสงที่เกิดจากการรวมตัว

รูปที่ 2.13 แผนภาพจำลองการคุณลักษณะแสงและการเปลี่ยนแสงที่เกิดจากการรวมตัว

สำหรับรายละเอียดของระบบการวัดโฟโตคูลมิเนสเซนซ์ในงานวิจัยนี้มีการจัดระบบตามแผนภาพดังในรูปที่ 2.14 เลเซอร์ชนิด  $\text{Ar}^+$  เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีค่าความยาวคลื่น 488 nm ซึ่งเทียบเท่ากับโฟตอนที่มีค่าพลังงาน 2.54 eV โดยทำหน้าที่กระตุ้นตัวอย่างในการทดลอง ตัวอย่างจะถูกติดไว้ในระบบทำความเย็นชนิดไครโอล Jenikแบบวงจรปิด (Closed circuit cryogenic system) ซึ่งภายในใช้การหล่อเย็นด้วย液化 Helium และอุณหภูมิต่ำที่สุดในการทดลองนี้คือ 10 K แสงที่ได้จากตัวอย่างถูกรวบรวมด้วยเลนซ์จำนวน 2 ชุด เพื่อให้แสงที่ได้ผ่านเข้าไปยังโนโน่โคโรนาเตอร์ (Monochromator) มีค่าความเข้มสูงขึ้น

โนโนโกรามาเตอร์ทำหน้าที่ในการแยกสเปกตรัมของแสงที่ได้จากตัวอย่าง และแสงที่ผ่านโนโนโกรามาเตอร์ได้เฉพาะแสงที่มีค่ากว่าความคลื่นความที่โนโนโกรามาเตอร์ได้ตั้งค่าไว้ จากนั้นแสงที่ผ่านโนโนโกรามาเตอร์เข้าสู่โฟโตมัลติพลาเยอร์ (Photomultiplier : PMT) เพื่อแปลงสัญญาณแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งสัญญาณนี้อยู่ในรูปของกระแสไฟฟ้าที่มีขนาดสัญญาณเล็กมาก ดังนั้นจึงต้องให้สัญญาณผ่านเครื่องขยายสัญญาณนิดลอกอินแอมป์ริไฟเออร์ (Lock-in Amplifier) ซึ่งทำหน้าที่ขยายสัญญาณที่ได้จาก PMT และแปลงสัญญาณให้เป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้า สัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่ได้นี้ผ่านมัลติมิเตอร์แบบเชิงเลข (Digital Multimeter : DMM) และส่งข้อมูลเชิงเลข (Digital format) ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการสร้างกราฟสเปกตรัมความสัมพันธ์ระหว่างค่าขนาดสัญญาณแสงที่ได้ และค่าความยาวคลื่นหรือค่าพลังงานไฟตอนของตัวอย่างแต่ละตัวอย่าง



รูปที่ 2.14 แผนภาพระบบการวัดโฟโตลูมิเนสเซนซ์

## 2.5 การวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าวิธี van der PAUW

วิธีการวัดของ van der PAUW เป็นวิธีการวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำที่ได้ประยุกต์มาจากการวัดของฮอลล์ (Hall effect) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำและสามารถวัดหาค่าตัวแปรต่างๆ ได้แก่ ชนิดของพาหะนำไฟฟ้าส่วนใหญ่ (Majority charge carrier) ค่าความหนาแน่นพาหะนำไฟฟ้า (Carrier concentration) และค่าความคล่องตัวของพาหะนำไฟฟ้า (Carrier mobility) แต่อย่างไรก็ตามการคำนวณจากการวัดวิธีดังกล่าวนี้จำเป็นที่จะต้องรู้ค่าสภาพนำไฟฟ้า (Conductivity) หรือค่าสภาพด้านทาน (Resistivity) ในปัจจุบันวิธีการวัดของ van der PAUW มีความสำคัญอย่างมากต่ออุตสาหกรรมวัสดุและสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำจนเป็นที่ยอมรับให้เป็นวิธีมาตรฐาน เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่าย สะดวกและผลการวัดที่แม่นยำ

### 2.5.1 ปรากฏการณ์ฮอลล์ (Hall Effect)

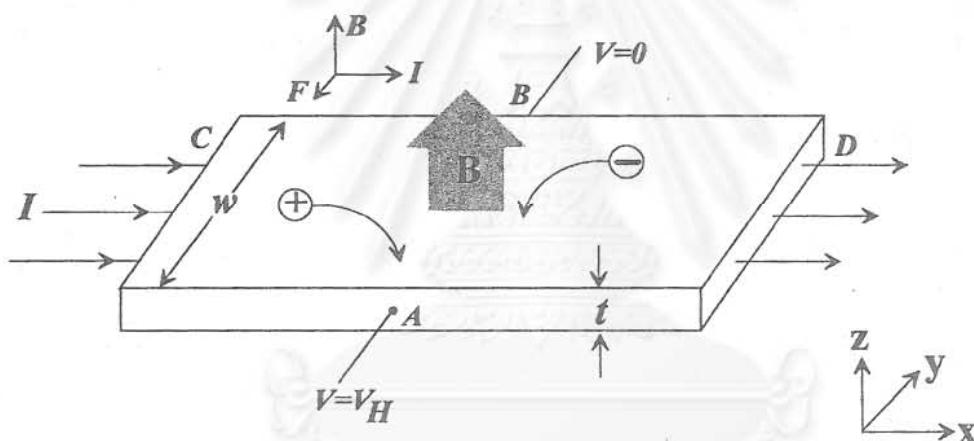
ปรากฏการณ์ฮอลล์ได้ถูกกันพบในปี ค.ศ. 1879 โดย Edwin H. Hall ซึ่งพบการเกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้นในแนวตั้งจากกันทิศทางการไหลของกระแสและสนามแม่เหล็กในเพ่นโลหะบางตามรูปที่ 2.15 ซึ่งต่อมาได้มีการอธิบายปรากฏการณ์นี้ด้วยแบบจำลองที่เกี่ยวข้องกับแรงของลอเรนท์ (Lorentz force) โดยแรงของสนามแม่เหล็กที่กระทำต่อประจุนำไฟฟ้ามีค่า

$$F_y = V_x \times B_z \quad (2.3)$$

โดย  $F_y$  คือแรงกระทำในแนวแกน  $y$  ที่เกิดขึ้นจากสนามแม่เหล็ก

$V_x$  คือค่าความเร็วของอิเล็กตรอนในแนวแกน  $x$

$B_z$  คือค่าความเข้มสนามแม่เหล็กในแนวแกน  $z$



รูปที่ 2.15 แผนภาพปรากฏการณ์ฮอลล์

เนื่องจากแรงกระทำที่มีต่อประจุนำไฟฟ้าในสภาวะสมดุล ทำให้เกิดจากสนามไฟฟ้าในแกน  $y$  ตามสมการ

$$E_y = \frac{J_x}{qp_0} B_z \quad (2.4)$$

โดย  $E_y$  คือค่าสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในแนวแกน  $y$

$J_x$  คือค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าในแนวแกน  $x$

$q$  คือค่าคงตัวประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอน

$p_0$  คือค่าความเข้มข้นประจุไฟฟ้าบวก

ในการปฏิบัติเรารสามารถวัดค่าสนามไฟฟ้าจากค่าแรงดันชอลล์ (Hall voltage) ที่เกิดขึ้น ในกรณีของพาหะส่วนใหญ่ที่เป็นโซลตามความสมพันธ์

$$E_y = \frac{V_{AB}}{w} = \frac{I_x}{wt} \frac{1}{qp_0} B_z \quad (2.5)$$

โดย  $V_{AB}$  คือค่าแรงดันชอลล์ที่เกิดขึ้น

$w$  คือค่าความกว้างของชิ้นตัวอย่าง

$I_x$  คือค่ากระแสไฟฟ้า

$B_z$  คือค่าความหนาของชิ้นตัวอย่าง

สำหรับในกรณีที่พาหะส่วนใหญ่เป็นอิเล็กตรอน สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้มีทิศทางในทางตรงกันข้าม ซึ่งวิธีการวัดนี้ทำให้เรารสามารถรู้ชนิดของพาหะประจุนำไฟฟ้าได้ จากสมการข้างต้น เราสามารถคำนวณหาค่าความหนาแน่นหรือค่าความเข้มข้นพาหะในกรณีของพาหะส่วนใหญ่ที่เป็นโซลได้จาก

$$p_0 = \frac{I_x B_z}{q V_{AB}} \quad (2.6)$$

จากสมการของค่าสภาพต้านทาน (Resistivity)

$$\rho (\Omega \cdot \text{cm}) = \frac{R_{wt}}{L} = \frac{V_{CD}}{I_x} \frac{wt}{L} \quad (2.7)$$

โดย  $V_{CD}$  คือค่าแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในแนวแกน  $x$  ที่วัดระหว่างจุด C และ D

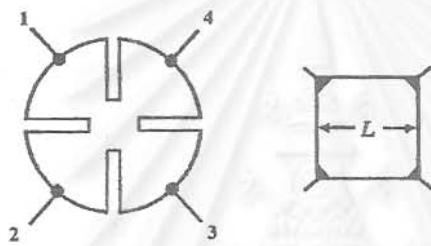
เราสามารถคำนวณหาค่าความคล่องของพาหะได้จากค่าสภาพต้านทานตามสมการ

$$\mu = \frac{1}{\rho q p_0} \quad (2.8)$$

ดังนี้ในการวัดเพื่อหาค่าความหนาแน่นของพาหะและความคล่องตัวพาหะในปรากฏการณ์ชอลล์ จึงจำเป็นต้องมีการวัดหาค่าความต้านทานรวมอยู่ในการวัดนี้ เพื่อทำให้เรารสามารถคำนวณหาผลได้ตามต้องการ

## 2.5.2 วิธีการวัดของ van der PAUW

เนื่องจากวิธีการวัดค่าต่างๆ ด้วยปรากฏการณ์ของชอล์นน์มีความยุ่งยากซับซ้อน มีการวัดหาค่าสภาพนำไฟฟ้าหรือสภาพด้านท่านเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อนำค่ามาใช้ในการคำนวณหาค่าความคิดองตัวของพานะและค่าความหนาแน่นของพานะ ดังนั้นวิธีการวัดของ van der PAUW [24] จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็นการสะดวกและง่ายสำหรับการเตรียมตัวอย่าง โดยการวัดนี้ยังคงใช้พื้นฐานจากปรากฏการณ์ชอล์น์และวัดได้ผลลัพธ์เทียบเท่ากันไม่แตกต่างจากวิธีแบบเดิม สำหรับตัวอย่างในวิธีการวัดของ van der PAUW นั้นมีรูปร่างและลักษณะตามรูปที่ 2.16 โดยแบบ Cloverleaf ตามรูปที่ 2.16 (ก) เป็นแบบที่ดีที่สุด แต่มีความยุ่งยากในกระบวนการเตรียมตัวอย่าง และในการทดลองนี้ใช้แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตามรูปที่ 2.16 (ข) เนื่องจากการเตรียมทำได้ง่ายและสะดวกกว่า



(ก) แบบ Cloverleaf      (ข) แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส

รูปที่ 2.16 ภาพโครงสร้างของตัวอย่างสำหรับการวัดหาค่าคุณสมบัติทางไฟฟ้าวิธี van der PAUW

โดยวิธีการวัดของ van der PAUW สามารถวัดหา Sheet resistive ( $R_s$ ) จากสมการ

$$\exp\left(\frac{-\pi R_A}{R_s}\right) + \exp\left(\frac{-\pi R_B}{R_s}\right) = 1 \quad (2.9)$$

ซึ่งค่า  $R_A$  และ  $R_B$  นั้นเป็นค่าความด้านท่านที่วัดตามรูปที่ 2.17 โดยการป้อนกระแสไฟฟ้าตรงที่มีค่าคงที่ที่ข้อ 1 ให้ผ่านตัวอย่างออกที่ข้อ 2 และทำการวัดค่าแรงดันที่ข้อ 3 และ 4 ในทำนองเดียวกันทำการป้อนกระแสไฟฟ้าตรงที่มีค่าคงที่ที่ข้อ 2 ให้ผ่านตัวอย่างออกที่ข้อ 3 และทำการวัดค่าแรงดันที่ข้อ 1 และ 4 จากนั้นนำค่าที่ได้มาคำนวณหาค่า  $R_A$  และ  $R_B$  ตามสมการ

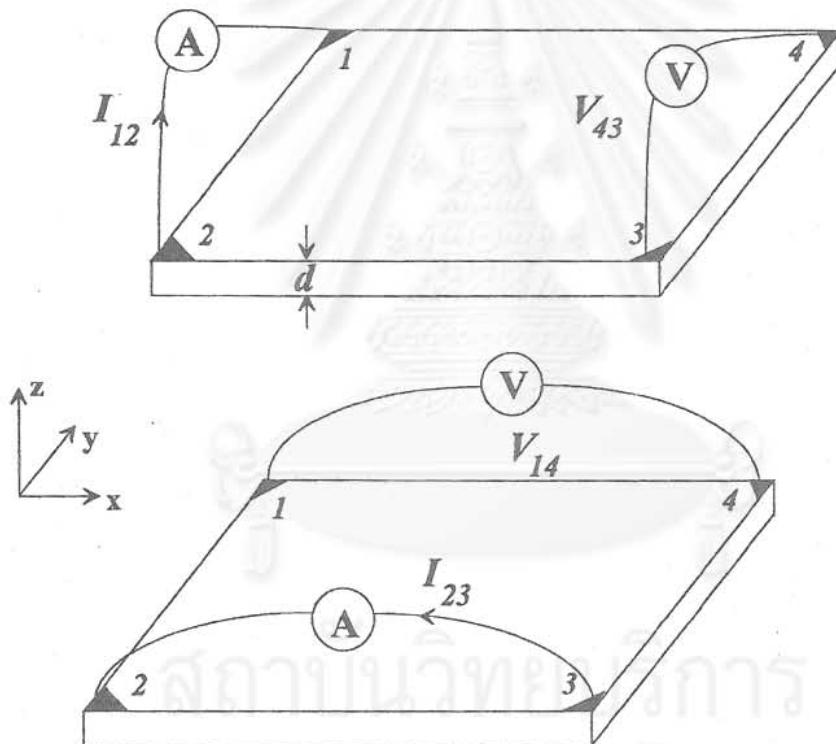
$$R_A = \frac{V_{43}}{I_{12}} \quad \text{และ} \quad R_B = \frac{V_{14}}{I_{23}} \quad (2.10)$$

โดยค่า  $R_s$  มีความสัมพันธ์กับค่าสภาพด้านท่านตามสมการ

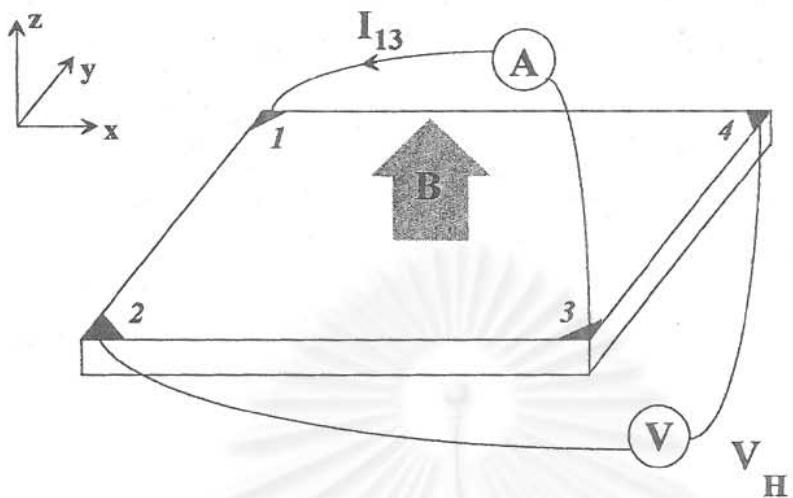
$$\rho = R_s d \quad (2.11)$$

โดย  $d$  คือค่าความหนาของตัวอย่าง

สำหรับการวัดหาค่าแรงดันของโลหะในวิธีการวัดของ van der PAUW ซึ่งเป็นค่าสำคัญที่นำมาใช้ในการคำนวณหาค่าความหนาแน่นพาราเบอลิกและค่าความคล่องตัวพาราเบอลิกได้ด้วยการป้อนกระแสไฟฟ้าตรงที่มีค่าคงที่ที่ข้อ 1 ให้ผ่านตัวอย่างออกที่ข้อ 3 และทำการวัดค่าแรงดันที่ข้อ 2 และ 4 โดยตัวอย่างอยู่ภายใต้สนามแม่เหล็กตามรูปที่ 2.18



รูปที่ 2.17 แผนภาพการวัดหาค่าสภาพด้านท่านในวิธีการวัดของ van der PAUW



รูปที่ 2.18 แผนภาพการวัดหาค่าแรงดันชั้นชอลส์ในวิธีการวัดของ van der PAUW

จากค่าแรงดันชั้นชอลส์ที่วัดได้นี้ เราสามารถนำไปคำนวณหาค่าความหนาแน่นของพายะและค่าความคล่องตัวของพายะได้ ซึ่งวิธีการคำนวณจะได้กล่าวถึงต่อไป

### 2.5.3 การวัด van der PAUW ในทางปฏิบัติ

แบบจำลองของ van der PAUW ที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นแบบจำลองในอุดมคติ ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นมีผลกระทบจากตัวแปรอื่นๆ ได้แก่ ความไม่เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสในอุดมคติของรูปร่างตัวอย่าง ขนาดของข้อโลหะมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดของตัวอย่าง และค่าความต้านทานของข้อโลหะรวมถึงค่าความต้านทานของหัวต่อโลหะ-สารกึ่งตัวนำที่มีค่าสูง เป็นต้น นอกจากนี้ในขณะที่ทำการวัดนี้จำเป็นที่ต้องป้องกันการเกิดพายะส่วนเกินเนื่องจากการกระตุนด้วยแสงและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของตัวอย่าง ดังนั้นตัวอย่างต้องอยู่ในที่ไม่มีแสงและมีการควบคุมอุณหภูมิ โดยเฉพาะค่ากระแสที่ใช้ในการวัดนี้ต้องไม่มีค่าสูงเกินไปจนทำให้อุณหภูมิของตัวอย่างเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นในการวัดนี้เราจะใช้ค่ากระแสในการวัดให้มีค่าน้อยที่สุด (ค่ากระแสนี้ขึ้นกับชนิดของวัสดุตัวอย่าง รูปร่าง และสภาพการระบายน้ำร้อนของระบบการวัด ฯลฯ ) ดังนั้นเพื่อการวัดให้ได้ค่าที่ถูกต้องสูงสุด

### 2.5.3.1 การคำนวณนิยามในการวัดค่าสภาพด้านท่าน

จากกฎปร่างของตัวอย่างนั้นมีข้อความนำไฟฟ้าอยู่ 4 ข้อ ซึ่งกำกับหมายเลข 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา เรายกตัวอย่างให้

$I_{12}$  เป็นค่ากระแสไฟฟ้าตรงที่ไม่จากผ่านข้อ 1 ผ่านตัวอย่างไปออกที่ข้อ 2 ในทำนองเดียวกัน สำหรับ  $I_{23}, I_{34}, I_{41}, I_{21}, I_{14}, I_{43}, I_{32}$  และมีหน่วยเป็นแอมป์เรียร์

$V_{12}$  เป็นค่าแรงดันที่วัดได้ที่ระหว่างข้อ 1 และ 2 ในทำนองเดียวกันสำหรับ  $V_{32}, V_{34}, V_{41}, V_{21}, V_{14}, V_{43}, V_{32}$  และมีหน่วยเป็นโวลต์

### 2.5.3.2 การวัดหาค่าสภาพด้านท่าน

สำหรับในการวัดนั้นทำการป้อนกระแส  $I_{21}$  และวัดค่าแรงดัน  $V_{34}$  และทำการกลับทิศทางกระแส  $I_{12}$  และวัดค่าแรงดัน  $V_{43}$  จากนั้นทำการวัดในทำนองเดียวกันกับ 6 ค่าที่เหลือคือ  $V_{41}, V_{14}, V_{12}, V_{21}, V_{23}$  และ  $V_{32}$  จากนั้นนำค่าที่วัดได้ทั้ง 8 ค่ามาคำนวณหาค่าความด้านท่าน เพื่อให้จำแนกค่าความด้านท่านได้ง่ายขึ้น เรากำหนดให้  $R_{I,V}$  เป็นค่าความด้านท่านที่ได้จากการป้อนกระแสที่กู้ขึ้น 1 และแรงดันที่วัดได้ที่กู้ขึ้น 7 ตามสมการ

$$R_{21,34} = \frac{V_{34}}{I_{21}}, R_{12,43} = \frac{V_{43}}{I_{12}} \quad (2.12 \text{ a})$$

$$R_{32,41} = \frac{V_{41}}{I_{32}}, R_{23,14} = \frac{V_{14}}{I_{23}} \quad (2.12 \text{ b})$$

$$R_{43,12} = \frac{V_{12}}{I_{43}}, R_{34,21} = \frac{V_{21}}{I_{34}} \quad (2.12 \text{ c})$$

$$R_{14,23} = \frac{V_{23}}{I_{14}}, R_{41,32} = \frac{V_{32}}{I_{41}} \quad (2.12 \text{ d})$$

จากการผลการวัดนี้เรารสามารถตรวจสอบได้ว่า

$$R_{21,34} \approx R_{12,43} \quad (2.13 \text{ a})$$

$$R_{32,41} \approx R_{23,14} \quad (2.13 \text{ b})$$

$$R_{43,12} \approx R_{34,21} \quad (2.13 \text{ c})$$

$$R_{14,23} \approx R_{41,32} \quad (2.13 \text{ d})$$

สำหรับในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องจากความไม่คงที่ของกระแสไฟฟ้าและความแปรปรวนของอุณหภูมิ เราสามารถตรวจสอบได้จากสมการข้างต้น ซึ่งความแตกต่างของค่าในแต่ละสมการไม่ควรเกิน 3% ในทำนองเดียวกันเราจะได้

$$R_{21,34} + R_{12,43} \approx R_{43,12} + R_{34,21} \quad (2.14 \text{ a})$$

$$R_{32,41} + R_{23,14} \approx R_{14,23} + R_{41,32} \quad (2.14 \text{ b})$$

สำหรับการคำนวณหาค่าสภาพด้านท่านนั้นเราสามารถคำนวณหาได้จากค่าความด้านท่าน 2 ค่าที่ได้จากการวัดดังนี้

$$R_A = \frac{(R_{21,34} + R_{12,43} + R_{43,12} + R_{34,21})}{4} \quad (2.15 \text{ a})$$

$$R_B = \frac{(R_{32,41} + R_{23,14} + R_{14,23} + R_{41,32})}{4} \quad (2.15 \text{ b})$$

จากค่า  $R_A$ ,  $R_B$  เราสามารถคำนวณหาค่า Sheet resistance ( $R_s$ ) และค่าสภาพด้านท่าน ( $\rho$ ) ได้จากสมการ (2.9) ในกรณีที่เรารู้ค่าความหนาของด้วอย่างจากสมการ (2.11) จากนั้นเราจะนำค่าที่วัดและคำนวณในขั้นตอนนี้ไปใช้ในการหาค่าความคล่องพากะต่อไป

### 2.5.3.3 การคำนวณในการวัดอัลล์

ในการวัดอัลล์นี้เป็นการวัดค่าแรงดันที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของพากะประจุนำไฟฟ้าที่เดี่ยวเบนไปภายใต้สนามแม่เหล็ก ซึ่งวิธีการนี้ทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าพากะนำไฟฟ้าส่วนใหญ่นั้นเป็นอิเล็กตรอนหรือโพลและทราบค่าความเข้มข้นพากะหรือค่าความหนาแน่นของพากะนำไฟฟ้าได้

$I_{13}$  คือค่ากระแสไฟตรงที่ป้อนเข้าที่ข้อที่ 1 ผ่านด้าอย่างออกที่ข้อ 3 ในทำนองเดียวกันสำหรับ  $I_{31}$ ,  $I_{42}$  และ  $I_{24}$

$B$  คือค่าสนามแม่เหล็กที่มีทิศทางในแนวแกน  $z$  โดยกำหนดให้สนามแม่เหล็กมีค่าเป็นบวกเมื่อมีทิศทางไปตามในแนวแกนทางบวกและมีค่าเป็นลบในกรณีตรงกันข้าม

$V_{24P}$  คือค่าแรงดันขอลดที่วัดได้ระหว่างขั้วที่ 2 และ 4 ภายใต้สถานะแม่เหล็กในทิศทางบวกในกรณีที่มีกระแสไฟฟ้า  $I_{13}$  ในท่านองเดียวกันกับ  $V_{42P}$ ,  $V_{13P}$  และ  $V_{31P}$  สำหรับ  $V_{24N}$ ,  $V_{42N}$ ,  $V_{13N}$  และ  $V_{31N}$  เป็นค่าที่วัดในท่านองเดียวกัน โดยสถานะแม่เหล็กที่ทิศทางไปในทางลบ

#### 2.5.3.4 การวัดหาค่าแรงดันขอลด

สำหรับในการวัดขอลนี้สามารถทำได้โดยการป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าที่ขั้ว 1 ให้ไหลผ่านตัวอย่างของที่ขั้ว 3 โดยตัวอย่างอยู่ภายใต้สถานะแม่เหล็ก B ที่มีทิศทางในทางบวก ค่าแรงดันขอลดที่วัดได้ในที่นี่คือ  $V_{24P}$  และวัดในกรณีที่มีการกลับทิศทางการไหลของกระแสเป็น  $I_{31}$  และวัดค่าแรงดันขอลด  $V_{42P}$  ด้วยวิธีการวัดในลักษณะเดียวกันจะได้  $V_{13P}$  และ  $V_{31P}$  ด้วยกระแส  $I_{42}$  และ  $I_{24}$  ตามลำดับ จากนั้นทำการวัดในท่านองเดียวกันโดยการกลับทิศทางสถานะแม่เหล็ก วัดค่าแรงดัน  $V_{24N}$ ,  $V_{42N}$ ,  $V_{13N}$  และ  $V_{31N}$  ด้วยกระแส  $I_{13}$ ,  $I_{31}$ ,  $I_{42}$  และ  $I_{24}$  ตามลำดับ

จากการวัดภายใต้สถานะแม่เหล็ก วัดแรงดันขอลดได้ 8 ค่า  $V_{24P}$ ,  $V_{42P}$ ,  $V_{13P}$ ,  $V_{31P}$ ,  $V_{24N}$ ,  $V_{42N}$ ,  $V_{13N}$  และ  $V_{31N}$  นำค่าแรงดันขอลดที่ได้มาคำนวณตามสมการ

$$V_C = V_{24P} - V_{24N} \quad (2.16 \text{ a})$$

$$V_D = V_{42P} - V_{42N} \quad (2.16 \text{ b})$$

$$V_E = V_{13P} - V_{13N} \quad (2.16 \text{ c})$$

$$V_F = V_{31P} - V_{31N} \quad (2.16 \text{ d})$$

จากค่าแรงดัน  $V_C$ ,  $V_D$ ,  $V_E$  และ  $V_F$  นี้เรารสามารถตรวจสอบได้ว่าชนิดของพานะนำไฟฟ้าส่วนใหญ่ของตัวอย่างว่าเป็นโซลหรืออิเล็กตรอน โดยพิจารณาจากผลบวกของ  $V_C$ ,  $V_D$ ,  $V_E$  และ  $V_F$  ในกรณีที่ผลบวกมีค่าเป็นบวก ตัวอย่างมีพานะนำไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นโซล ดังนั้นจึงเป็นชนิดพี (p-type) ส่วนในกรณีที่ผลบวกมีค่าเป็นลบตัวอย่างมีพานะนำไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นอิเล็กตรอนและเป็นชนิดเจ็น (n-type)

สำหรับค่า Sheet carrier density สามารถคำนวณหาได้จากสมการ

$$P_s = \frac{8 \times 10^{-8} IB}{q(V_C + V_D + V_E + V_F)} \quad (\text{cm}^{-2}) \quad (2.17)$$

ในการณ์ที่ผลบวกมีค่าเป็นมาก หรือ

$$n_s = \left| \frac{8 \times 10^{-8} I B}{q(V_C + V_D + V_E + V_F)} \right| \quad (\text{cm}^{-2}) \quad (2.18)$$

โดย  $B$  คือค่าสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นแก๊ส (Gauss : G)

$I$  คือค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรงมีหน่วยเป็นแอมป์ (Ampere : A)

ค่า  $B$  และ  $I$  ในการทดลองมีค่าคงที่ (Constant) ตลอดในการวัดแต่ละครั้ง  
ค่าความหนาแน่นพาหะนำไฟฟ้าสามารถคำนวณได้จากสมการ

$$n = \frac{n_s}{d} \quad (2.19)$$

$$P = \frac{P_s}{d} \quad (2.20)$$

ในทำนองเดียวกันค่าคล่องตัวพาหะนำไฟฟ้าสามารถคำนวณได้จากสมการ

$$\mu = \frac{1}{qn_s R_s} \quad (2.21)$$

# สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

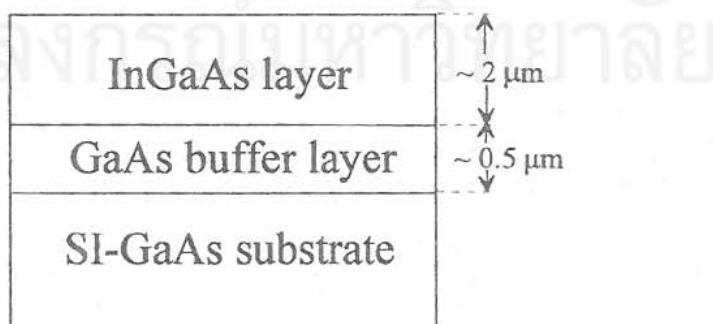
### บทที่ 3

#### การออกแบบการทดลอง

สำหรับในบทนี้ เป็นรายละเอียดและขั้นตอนของกระบวนการทดลองในงานวิจัยนี้ เพื่อทำการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรหรือเงื่อนไขต่างๆ ในการปัลส์กัลลิกที่มีผลต่อคุณสมบัติของชั้นผลึกอิเล็กซ์ InGaAs ( $E_g \approx 0.75$  eV) ที่ปัลส์กัลลิกฐาน GaAs ตัวแปรที่ได้ศึกษาในการทดลองนี้ ได้แก่ ค่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะทำการปัลส์กัลลิก และค่าอัตราส่วนความร้อนสมมูล (Beam-equivalent pressure : BEP) ของ  $\text{As}_x/(\text{In}+\text{Ga})$

#### 3.1 การเตรียมตัวอย่าง

ตัวอย่างในการทดลองนี้ มีโครงสร้างดังในรูปที่ 3.1 โดยตัวอย่างแต่ละชิ้นมีขนาดกว้างประมาณ  $\frac{1}{4}$  ของแผ่นผลึกฐานกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว และแผ่นผลึกฐานเริ่มต้นในการทดลองเป็น GaAs (100) ชนิดกึ่งฉนวน (Semi-insulator) แผ่นผลึกฐานเริ่มต้นถูกนำไปติดลง Mo Block ด้วย In หลอมละลาย จากนั้นนำ Mo Block ที่ติดแผ่นผลึกฐานเริ่มต้น GaAs เข้าสู่ระบบ MBE โดยเริ่มต้นทำการ Outgassing ที่  $400^\circ\text{C}$  เป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงภายใต้สภาวะสุญญากาศ ( $10^{-9}$  Torr) กระบวนการในขั้นนี้กระทำภายใน Preparation chamber หรือ Pre-heated chamber เพื่อทำความสะอาดผิวของแผ่นผลึกฐานเริ่มต้นด้วยความร้อนภายใต้สภาวะสุญญากาศ ต่อจากนั้นทำการลำเลียง Mo Block ที่ติดแผ่นผลึกฐาน GaAs เข้าสู่ Growth chamber สำหรับกระบวนการภาายน์ใน Growth chamber ในลำดับแรกทำการขัด Oxide ที่ผิวแผ่นผลึกฐานเริ่มต้น GaAs ที่อุณหภูมิ  $600^\circ\text{C}$  ภายใต้บรรยากาศ  $\text{As}_x$  จนผิวสะอาด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ RHEED pattern ที่ปรากฏขึ้นเป็นแบบ c(2x4) จากนั้นทำการปัลส์กัลลิกชั้น Buffer ผลึก GaAs หนา 5000 Å ที่อุณหภูมิ  $580^\circ\text{C}$  ด้วยค่าอัตราการปัลส์  $0.5 \mu\text{m}/\text{ชั่วโมง}$  และค่าอัตราส่วน  $\text{As}_x/\text{Ga}$  มีค่าประมาณ 20 ลำดับ ต่อไปทำการปัลส์กัลลิก InGaAs ตามเงื่อนไขตามในตารางที่ 3.1 โดยเวลาที่ใช้ในการปัลส์กัลลิก InGaAs เป็นเวลา 4 ชั่วโมง

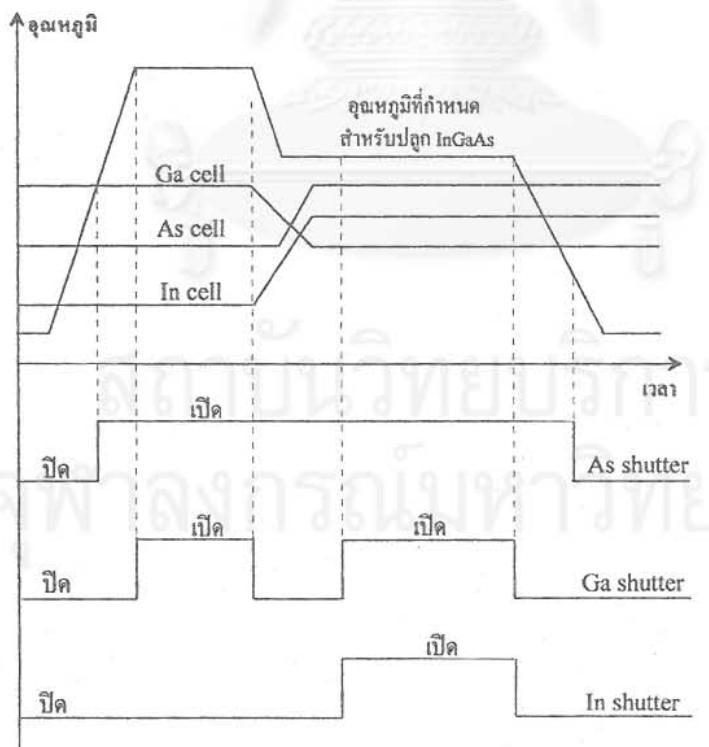


รูปที่ 3.1 แผนภาพโครงสร้างของตัวอย่างที่สร้างขึ้นในการทดลอง

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดของเงื่อนไขที่ใช้ในการปลูกพลีก InGaAs ( $E_g \approx 0.75$  eV) บนแผ่นผลึกฐาน GaAs

Growth temperature (°C)	BEP As <sub>4</sub> (X10 <sup>-6</sup> Torr)				
440	4.6	6.3	6.6	9	9.9
460	1	5.2	6.6	8.1	13.7
480	4.7	6.6	10.4	15	----

หลังจากปลูกชั้น GaAs buffer เสร็จสิ้นลงแล้ว ทำการลดอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานลงไปตามค่าที่กำหนดไว้สำหรับการปลูกพลีก InGaAs ในขณะเดียวกันทำการปรับค่าอุณหภูมิของเหลงจ่าย In, Ga และ As<sub>4</sub> ให้ได้ค่าตามที่ได้กำหนดไว้ โดยค่าความไอดันของเหลงจ่าย In และ Ga มีค่า  $P_{In} = 1.9 \times 10^{-7}$  Torr และ  $P_{Ga} = 1.1 \times 10^{-7}$  Torr ตามลำดับ และค่าความดันไอของเหลงจ่าย In และ Ga ใช้ค่านี้ตลอดการทดลอง สำหรับค่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะทำการปลูกพลีก InGaAs และค่าความดันไอของ As<sub>4</sub> ตามในตารางที่ 3.1 โดยแผนภาพจำลองกระบวนการการปลูกพลีกในการทดลองนี้ในการตั้งค่าอุณหภูมิของเหลงจ่าย In, Ga และ As<sub>4</sub> รวมถึงกระบวนการเปิดปิด Shutter ในการทดลองนี้ดังในรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 แผนภาพจำลองกระบวนการทำงานของการตั้งค่าอุณหภูมิและ Shutter ในการวิจัยนี้

### 3.2 การวิเคราะห์ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ได้จากการปั๊กผลึกอิพเทกซ์จากคำโน้ตถูกถูกลบนำไปวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าด้วยวิธี van de PAUW ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 2.4.3 โดยตัดตัวอย่างออกเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด  $5 \times 5 \text{ mm}^2$  ทำการสร้างขั้วโลหะชนิดผิวสัมผัสโดยทึบมิกด้วยการฉาบโลหะ In ที่มุนของตัวอย่างทั้งสี่มุนขนาดประมาณ  $0.5 \times 0.5 \text{ mm}^2$  และหนาประมาณ  $1000 \text{ \AA}$  ซึ่งจะบด้วยการระเหยไอโลหะในสูญญากาศ (Vacuum evaporation) จากนั้นทำการ Anneal ที่อุณหภูมิที่  $450^\circ\text{C}$  เป็นเวลา 1 นาที [25] เพื่อผิวสัมผัสโลหะ-สารกึ่งตัวนำมีคุณสมบัติเป็นโอมมิก (Ohmic contact) หรือเชิงเส้น โดยเงื่อนไขที่ใช้ในการวัดมีค่าไฟฟ้ากระแสตรง  $1 \text{ mA}$  และสนามแม่เหล็ก  $0.3 \text{ Tesla}$  สำหรับคุณภาพผิวน้ำผลึก (Surface morphology) ทำการตรวจสอบด้วย Atomic force microscope (AFM) สำหรับค่าคงตัวผลึกของผลึกที่ได้จากการวัดด้วย X-ray diffraction (XRD) ด้วยการเปรียบเทียบผลที่ได้จากผลึก InP ที่ปั๊กบนแผ่นผลึก GaAs สำหรับค่าความหนาของชั้นผลึก InGaAs ได้มีการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Scanning electron microscope) โดยผลที่ได้นี้แสดงไว้ในบทที่ 4

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 4

### บทการทดลองและการวิเคราะห์ผล

สำหรับในบทนี้นำเสนอผลการทดลองที่ได้ดำเนินการในงานวิจัยนี้ ได้แก่ ผลการศึกษาคุณสมบัติของชั้นผลึกอิพิเทกซ์ InGaAs ( $E_g \approx 0.75$  eV) ที่ปูลูกบนแผ่นผลึกฐานเริ่มต้น GaAs (100) ด้วยวิธีการปูลูกผลึกอิพิเทกซ์จากลำไบโนเลกุล และผลการทดลองที่ได้แสดงถึงอิทธิพลของตัวแปรที่ใช้ในการปูลูกผลึก ได้แก่ ค่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะทำการปูลูกผลึกและค่าความดันไอ Beam Equivalent Pressure (BEP) ของ  $\text{As}_4$  ที่มีต่อคุณสมบัติของชั้นผลึก InGaAs ที่ปูลูกได้

#### 4.1 การตรวจสอบค่าความหนาของชั้นผลึก InGaAs ที่ได้

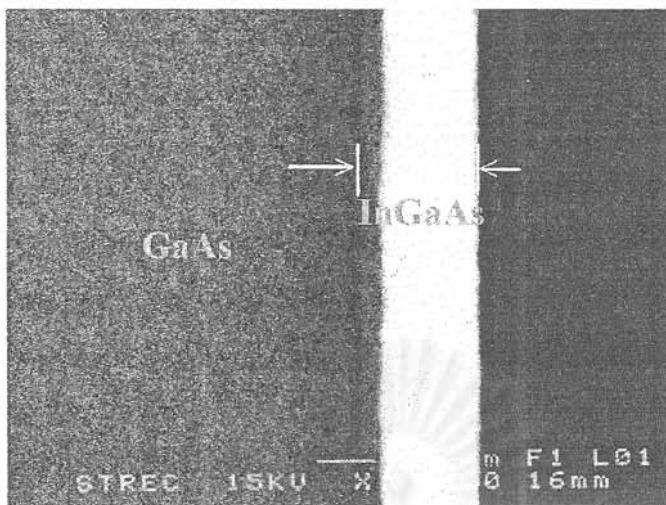
ชั้นผลึกอิพิเทกซ์ InGaAs ที่ปูลูกได้ในการทดลองนี้ เมื่อทำการตรวจสอบค่าความหนาของชั้นผลึกที่ปูลูกได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนการดูด (Scanning Electron Microscope) มีค่าความหนาประมาณ  $2.1 \mu\text{m}$  ดังในรูปที่ 4.1 เมื่อเปรียบเทียบค่าที่คำนวณจากค่า BEP ของ In และ Ga ที่ใช้ในการทดลองมีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งค่าที่ได้จากการคำนวณดังแสดงในหัวข้อนี้มีค่า  $1.976 \mu\text{m}$  ค่าที่ได้มีความผิดพลาดประมาณ 5.9% โดยค่าความผิดพลาดนี้เกิดจากค่าที่อ่านได้จาก Ionization gauge meter ที่อ่านได้เป็นค่าตัวเลขเพียง 2 หลัก (Digit) เท่านั้น จากค่าที่ใช้ในการทดลองนี้คือ  $1.1 \times 10^{-7}$  Torr และ  $1.9 \times 10^{-7}$  Torr สำหรับ Ga และ In ตามลำดับ ซึ่งค่าความผิดพลาดจากการอ่านสูงสุด  $0.1 \times 10^{-7}$  Torr หรือประมาณ 14.4% เนื่องจากค่าความไว (Sensitivity) ของ Ionization guage ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ซึ่งค่า BEP ที่วัดได้นั้นมีค่าน้อยกว่าค่าจริงเสมอ [26]

สำหรับการคำนวณค่าความหนาของ InGaAs ในการทดลองนี้สามารถคำนวณได้ดังนี้

จากค่า BEP ของ Ga ที่ใช้ในการปูลูกผลึก GaAs มีค่า  $5.4 \times 10^{-7}$  Torr โดยเทียบเท่ากับอัตราการปูลูกผลึก  $1 \mu\text{m}/\text{ชั่วโมง}$  ซึ่งได้จากผู้ผลิตเครื่อง MBE [27] ดังนั้นจากสมการ (2.2) เราสามารถคำนวณกลับ เพื่อหาจำนวนอะตอมที่พ่นลงบนผิวน้ำของแผ่นผลึกฐาน ซึ่งเราสามารถคำนวณจากสมการจำนวน Monolayer ที่ปูลูกได้ตามสมการ

$$1 \text{ Monlayer}_{\text{GaAs}} = \frac{a_{\text{GaAs}}}{2} = \frac{5.6533}{2} = 2.82665 \text{ \AA} \quad (4.1)$$

$$R_{\text{GaAs}} = \frac{10000}{3600 \times 2.82665} = 0.9827 \text{ Monolayer/วินาที} \quad (4.2)$$



รูปที่ 4.1 ภาพภาคตัดขวางของตัวอย่างชั้นผลึกอิพิเทกซ์ InGaAs ที่ปูลูกบันแผ่นผลึกฐาน (100) GaAs  
เส้นขีดขาวแนวนอนในรูปแทนค่าความยาว 1 ไมครอน

ซึ่งค่าอัตราการปูลูกข้างต้นสามารถเปรียบได้กับค่าความหนาแน่นอะตอมที่พ่นลงบนผิวน้ำแข็ง  
ผลึกฐาน

$$J_{Ga} = \frac{2}{(5.6533 \times 10^{-8})^2} \times 0.9827 = 6.1496 \times 10^{14} \text{ อะตอม/ตร.ซม./วินาที} \quad (4.3)$$

เนื่องจากค่า BEP ของ Ga และ In ที่ใช้ในการทดลองนี้มีค่า  $1.1 \times 10^{-7}$  Torr และ  $1.9 \times 10^{-7}$  Torr ตามลำดับ เพื่อทำการเปรียบเทียบค่า BEP ของ In ให้มีค่าเท่ากับค่าเปรียบเทียบของ Ga ได้ตามสมการ

$$\text{BEP ของ In ที่เปรียบเท่า BEP ของ Ga} = \text{BEP ของ In} \times \frac{\text{Gauge Sensitivity of Ga}}{\text{Gauge Sensivity of In}} \quad (4.4)$$

โดยค่า Guage sensitivity ของ Ga และ In มีค่า 1.68 และ 2.44 ตามลำดับ ดังนั้นเราสามารถคำนวณ  
หาค่า BEP สมมูลของ In เทียบเท่า Ga ได้ตามสมการ

$$\begin{aligned} \text{BEP ของ In ที่เปรียบได้กับของ Ga} &= 1.9 \times 10^{-7} \times \frac{1.68}{2.44} \text{ Torr} \\ &= 1.2848 \times 10^{-7} \text{ Torr} \end{aligned} \quad (4.5)$$

ดังนั้นค่าความหนาแน่นอะตอมของ Ga และ In ทั้งหมดที่พ่นลงบนผิวน้ำแข็งแผ่นผลึกฐานได้  
ตามสมการ

$$J_{InGa} = \frac{1.2848 \times 10^{-7} + 1.1 \times 10^{-7}}{5.4 \times 10^{-7}} \times 6.1496 \times 10^{14} = 2.7158 \times 10^{14} \text{ อัตโนมัติ/ตร.ซม./วินาที} \quad (4.6)$$

สำหรับค่าความหนาแน่นของอัตโนมัติของ Ga และ In ที่ผิวในระนาบ (100) มีค่า

$$\text{Surface density}_{InGaAs\ 1\ Monolayer} = \frac{2}{(5.8686 \times 10^{-8})^2} = 5.807 \times 10^{14} \text{ อัตโนมัติ/ตร.ซม./วินาที} \quad (4.7)$$

ดังนั้นค่าอัตราการปลูกผลึกที่เกิดขึ้นของ InGaAs ในกรณีมีค่าตามสมการ

$$R_{InGaAs} = \frac{J_{InGa}}{\text{Surface density}_{1\ Monolayer}} = \frac{2.7158 \times 10^{14}}{5.807 \times 10^{14}} = 0.4677 \text{ Monolayer/วินาที} \quad (4.8)$$

เมื่อคำนวณหาค่าความหนาของผลึกที่ปลูกจากค่าอัตราการปลูกผลึกดังกล่าวข้างต้นได้ตามสมการ

$$\begin{aligned} R_{InGaAs} &= 0.4677 \times \frac{a_{InGaAs}}{2} = 0.4677 \times \frac{5.8686}{2} = 1.3723 \text{ Å/วินาที} \\ &= 1.3723 \times 3600 = 0.494 \mu\text{m}/ชั่วโมง \end{aligned} \quad (4.9)$$

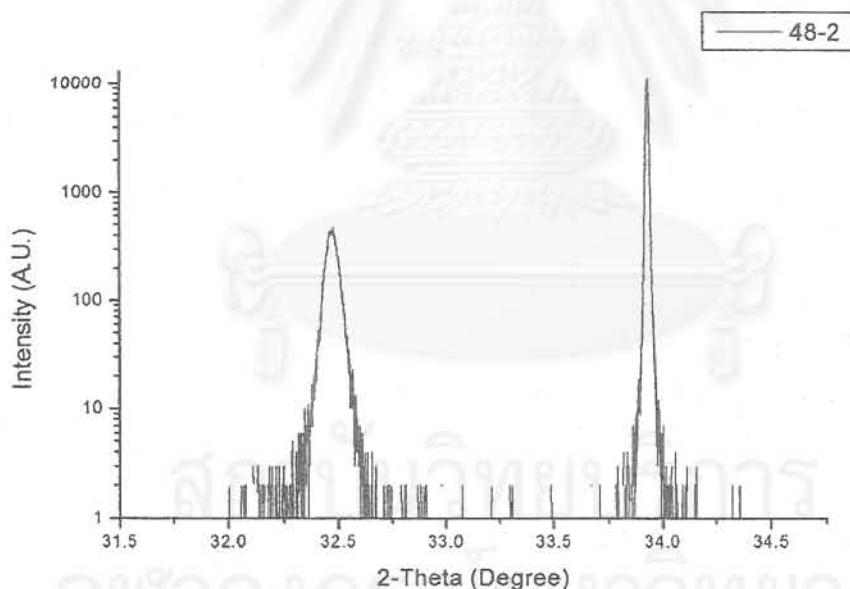
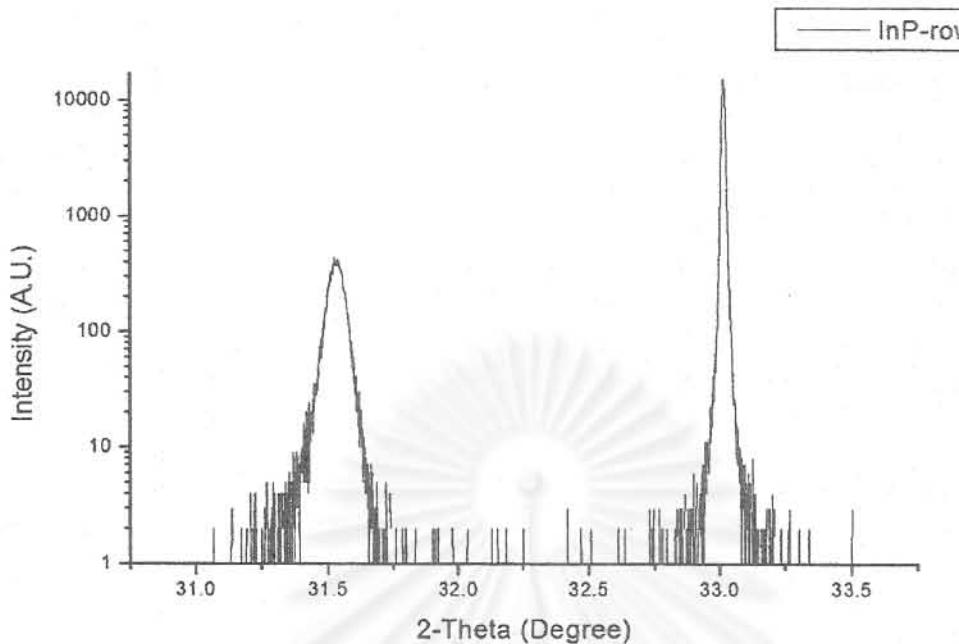
เพราะะนั้นค่าความหนาขึ้นผลึกอิพเทกซ์ InGaAs ที่ปลูกในเวลา 4 ชั่วโมงมีค่าความหนา

$$d_{InGaAs} = 0.494 \times 4 = 1.976 \mu\text{m} \quad (4.10)$$

จากรูปที่ 4.1 ค่าความหนาที่ได้จากการปลูกมีค่าความหนาประมาณ 2.1 μm ซึ่งใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากการคำนวณ โดยความผิดพลาดประมาณ 5% อันเกิดจากค่าผิดพลาดของค่าความดัน ไอที่อยู่ในได้จาก Ion gauge meter

#### 4.2 ผลการวัดผลด้วย X-RAY

สำหรับผลการวิเคราะห์ผลตัวอย่างที่ได้ด้วยการใช้การวัดด้วย XRD นี้ โดยตัวอย่างของผลการวัดด้วย XRD จากรูปที่ 4.2 ซึ่งค่าสัดส่วนของ In ในผลึก InGaAs ที่กำหนดให้มีค่าประมาณ 0.53 โดยค่าคงตัวผลึก (Lattice constant) ของ InGaAs ในกรณีนี้มีค่าคงตัวผลึกใกล้เคียงกับค่าของ InP ด้วยการเปรียบเทียบผลของตัวอย่าง InP ที่ปลูกบนแผ่นผลึก GaAs จากผลการวัด XRD ที่ได้นั้นมียอด (Peak) ปรากฏให้เห็น 2 ค่า ดังในรูปที่ 4.2 (ก) ค่ายอดที่ 31.6 องศานั้นเป็นค่าที่ได้ผลึก InP และค่ายอดที่ 33 องศาเป็นค่าที่ได้จากผลึกฐาน GaAs โดยค่า  $\Delta\theta$  สำหรับ InP บน GaAs มีค่าประมาณ 1.4 องศา สำหรับชั้นผลึก InGaAs



(ก) InP on GaAs

(ข) InGaAs on GaAs ตัวอย่าง 48-2

รูปที่ 4.2 ตัวอย่างสเปกตรัมของผลการวัด XRD ที่ได้จากตัวอย่าง (ก) InP บน GaAs

และ (ข) InGaAs บน GaAs ( $T_s = 460^\circ\text{C}$ ,  $\text{As}_4 = 5.3 \times 10^{-6}$  Torr)

ตารางที่ 4.1 ค่า  $\Delta\theta$  ที่ได้จากการวัด XRD ของชั้นผลึก InGaAs ที่ปูกรูบันแผ่นผลึกฐาน GaAs

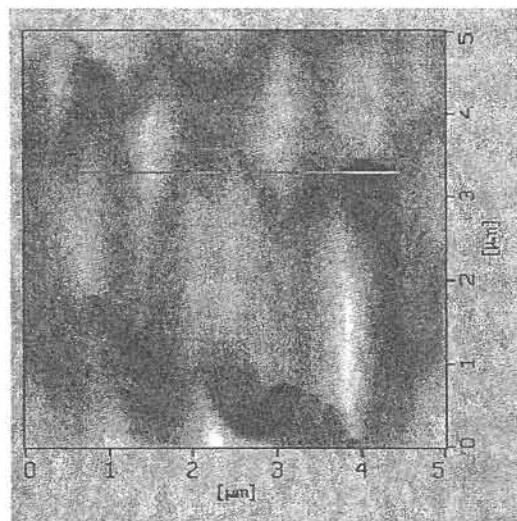
Growth temperature (°C)	$\Delta\theta$ (Degree) (BEP As <sub>4</sub> ( $\times 10^{-6}$ Torr))				
	1.53 (5.3)	1.45 (6.6)	1.40 (8.1)	1.51 (11)	1.49 (13.7)
440	1.494 (5.3)	1.469 (6.6)	1.507 (8.1)	1.511 (11)	1.452 (13.7)
460	1.43 (5.3)	1.46 (6.6)	1.38 (8.1)	1.42 (11)	1.41 (13.7)
480					

และผลการวัด XRD ซึ่งแสดงค่า  $\Delta\theta$  ระหว่างผลต่างของค่ายอดที่เปรียบกับ GaAs ในตารางที่ 4.2 ซึ่งค่าของผลต่างจากค่ายอดที่ได้จากการวัดด้วย XRD

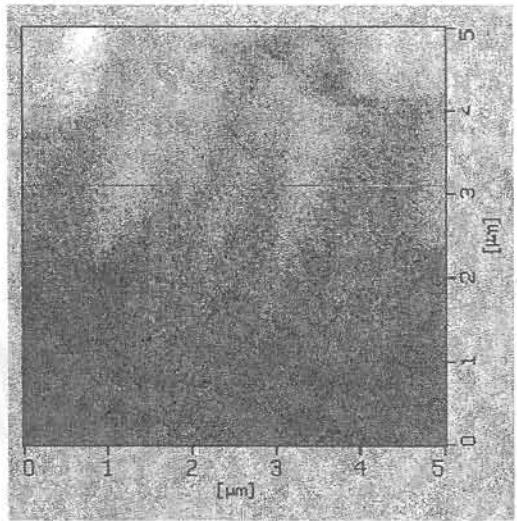
ข้อสังเกตุจากผล XRD ที่ได้นั้นตัวอย่างที่ปูกรูที่อุณหภูมิ 480 °C ค่า  $\Delta\theta$  ที่ได้มีค่าน้อยกว่า เนื่องจากผลของ In Segregation ที่ทำให้ In Incorporation ในชั้นผลึก InGaAs มีค่าสัดส่วน In ลดลง ที่เกิดจากค่าอุณหภูมิผิวน้ำขยะทำการปูกรูผลึก InGaAs มีค่าสูงขึ้นกว่า 480 °C อันเนื่องมาจากคุณสมบัติเชิงความร้อนของชั้นผลึก InGaAs ที่เป็นต้นเหตุให้ค่าอุณหภูมิผิวน้ำมีค่าสูงขึ้น [28] ซึ่งในกรณีนี้หากเราต้องการให้ค่าสัดส่วน In มีค่าเท่าเดิมสามารถทำได้ด้วยการเพิ่มค่าความดันไอของ In cell โดยผลจาก  $\Delta\theta$  ที่ได้จากการ XRD นี้บอกค่าความแตกต่างของค่าด้วยผลึกที่แตกต่างไปจากไปค่าคงตัวผลึกของ InP บนแผ่นผลึกฐาน เพียงเล็กน้อยเท่านั้น สำหรับค่าอุณหภูมิขยะทำการปูกรูผลึก และค่าความดันไอ As<sub>4</sub> ไม่มีผลต่อค่าคงตัวของ InGaAs นอกจากค่าอัตราส่วนความดันไอของ In และ Ga เท่านั้น

#### 4.3 ผลการวัด Surface morphology ด้วย AFM

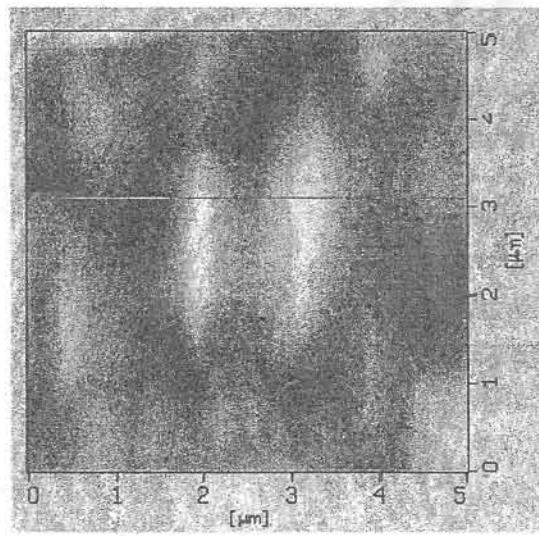
สำหรับผลการวัด Surface morphology ด้วย AFM ของตัวอย่างที่ได้ในการทดลองนี้สามารถสรุปได้ดังในรูปที่ 4.4 ภายในพื้นที่  $5 \times 5 \mu\text{m}^2$  ซึ่งผิวที่ได้นั้นมีค่า RMS (Root mean square) ของผิวที่ได้จากการคำนวณเปรียบเทียบกับค่าระดับสูนย์ที่กำหนดจากค่าตำแหน่งที่ต่ำที่สุดของผิวจากภาพ AFM ซึ่งในแต่ละอุณหภูมิขยะปูกรูผลึกนั้นมีค่าช่วง BEP As<sub>4</sub> ที่เหมาะสมนั้นดังในรูปที่ 4.4 โดยภาพตัวอย่าง Surface morphology ดังในรูปที่ 4.3 ซึ่งจากผลตามรูปที่ 4.4 การปูกรูผลึกอิพิแทกซ์ InGaAs ที่อุณหภูมิสูง คุณภาพของผิวน้ำที่ได้มีคุณภาพดีที่สุด ในการทดลองปูกรูผลึกที่ 480 °C ได้ค่า Surface roughness ต่ำที่สุดคือ



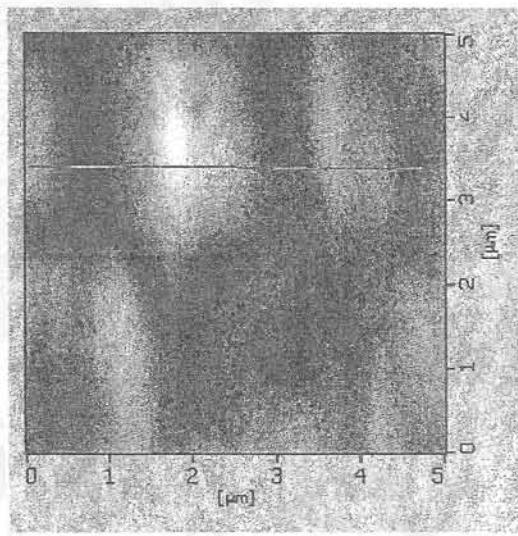
(n) 48-2 ( $T_s = 460 \text{ } ^\circ\text{C}$ ,  $\text{As}_4 = 6.6 \times 10^{-6} \text{ Torr}$ )



(o) 48-3 ( $T_s = 480 \text{ } ^\circ\text{C}$ ,  $\text{As}_4 = 6.6 \times 10^{-6} \text{ Torr}$ )



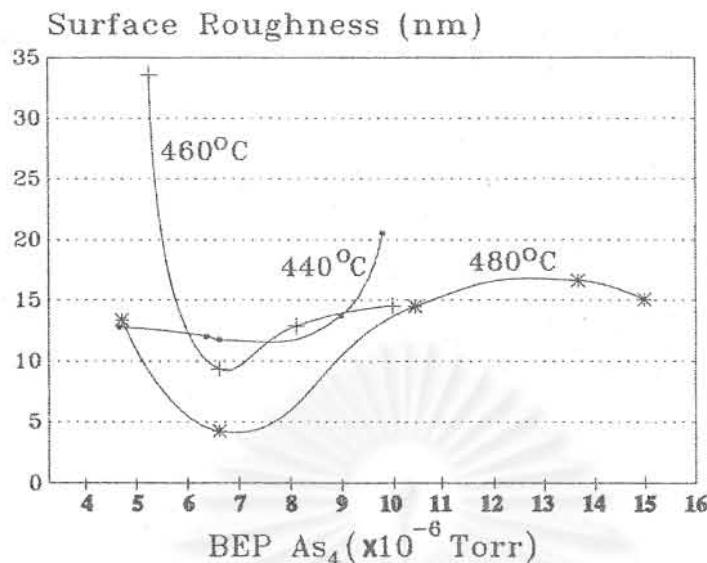
(p) 48-4 ( $T_s = 480 \text{ } ^\circ\text{C}$ ,  $\text{As}_4 = 1.04 \times 10^{-5} \text{ Torr}$ )



(q) 48-5 ( $T_s = 460 \text{ } ^\circ\text{C}$ ,  $\text{As}_4 = 1.04 \times 10^{-5} \text{ Torr}$ )

รูปที่ 4.3 ภาพ AFM ขนาด  $5 \times 5 \mu\text{m}^2$  ของหัวอย่างบางหัวอย่าง

และภาพแสดงภาคตัดขวางของผิวดามแนวเส้น翰ของในแต่ละภาพ



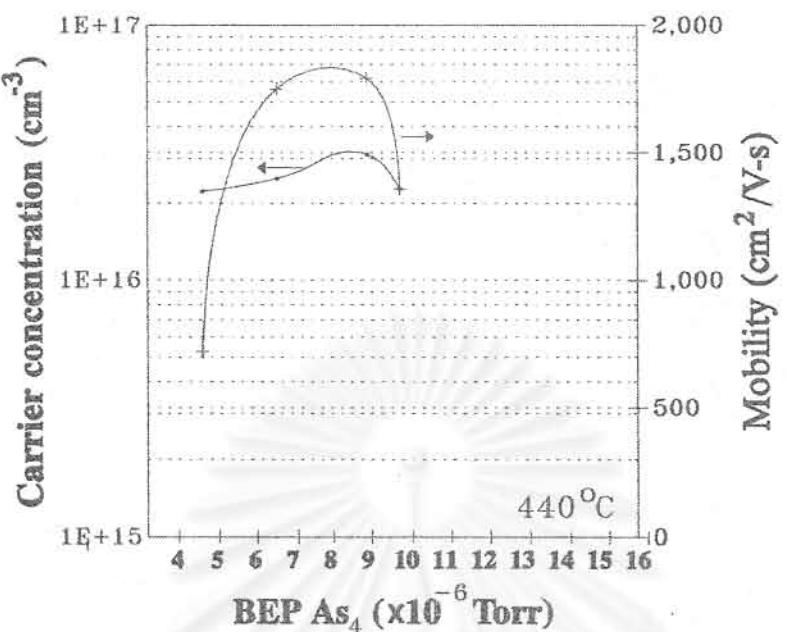
รูปที่ 4.4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Surface roughness และค่า BEP  $\text{As}_4$

4 nm และช่วงค่าความดันไอ  $\text{BEP As}_4$  มีค่าอยู่ในช่วง  $6 \times 10^{-6}$ - $8 \times 10^{-6}$  Torr เนื่องจาก การปลูกหลักที่อุณหภูมิสูงนี้  $\text{As}_4$  นั้น ได้สัดส่วนในของแข็งที่เหมาะสม แต่ในการณ์ที่อุณหภูมิต่ำลงมาที่  $440^{\circ}\text{C}$  และ  $460^{\circ}\text{C}$  ค่า Surface roughness มีค่าสูงขึ้น โดยเฉพาะการปลูกหลักที่  $440^{\circ}\text{C}$  คุณภาพผิวนี้แนวโน้มที่ Surface roughness มีค่าสูงขึ้น เมื่อค่าความดันไอ  $\text{BEP As}_4$  มีค่าสูงขึ้น อันเนื่องมาจากผลของ  $\text{As}_4$  ที่มีผลต่อคุณภาพผิวน้ำในลักษณะของ Cluster ของ As ส่วนเกินเกิดที่ผิวของหลัก สำหรับในการณ์ที่ทำการปลูกหลักที่อุณหภูมิสูงขึ้นผลนี้จะลดลง แต่ยังไร์กีตามในการปลูกหลักที่ค่าอุณหภูมิสูงขึ้นนี้จากมีผลทำให้ค่าสัดส่วนของ In และ Ga เปลี่ยนแปลงไปจากค่าที่ต้องการ สำหรับค่า RMS ของ Surface roughness นี้ได้จากค่าที่คำนวณจากโปรแกรมของเครื่อง AFM

จากการวัดคุณภาพผิวน้ำด้วย AFM เงื่อนไขที่ได้คุณภาพผิวดีที่สุดคืออุณหภูมิการปลูกหลักที่  $480^{\circ}\text{C}$  และมีค่าความดัน BEP ของ  $\text{As}_4$  ในช่วง  $6 \times 10^{-6}$ - $8 \times 10^{-6}$  Torr โดยมีค่า Surface roughness ของผิวหลักที่ได้อยู่ในช่วง 4-5 nm

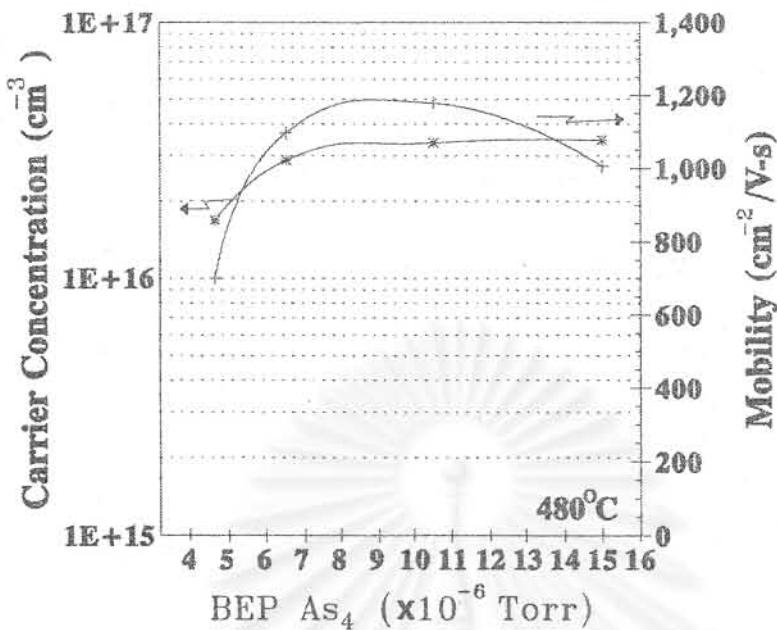
#### 4.4 ผลการวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าด้วยวิธี van der PAUW

ผลการทดลองวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าด้วยวิธี van der PAUW ของชั้นหลักอิพิแทกซ์ InGaAs ที่ปลูกแแห่นหลักฐาน (100) GaAs ที่ได้มีคุณสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น (n-type) หรือมีพาหนะนำไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นอิเล็กตรอน โดยอิทธิพลของค่าความดันไอ  $\text{As}_4$  ที่มีต่อคุณสมบัติทางไฟฟ้าของชั้นหลักอิพิแทกซ์ InGaAs ดังกราฟในรูปที่ 4.5 รูปที่ 4.6 และรูปที่ 4.7 ตามลำดับ ค่าความเข้มข้นพาหนะมี



รูปที่ 4.5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้นพาหะ ค่าความคล่องตัวและค่าความดันไอ As<sub>4</sub> ภายใต้เงื่อนไขการปั๊กผลึกที่อุณหภูมิแผ่นผลึกฐาน 440 °C

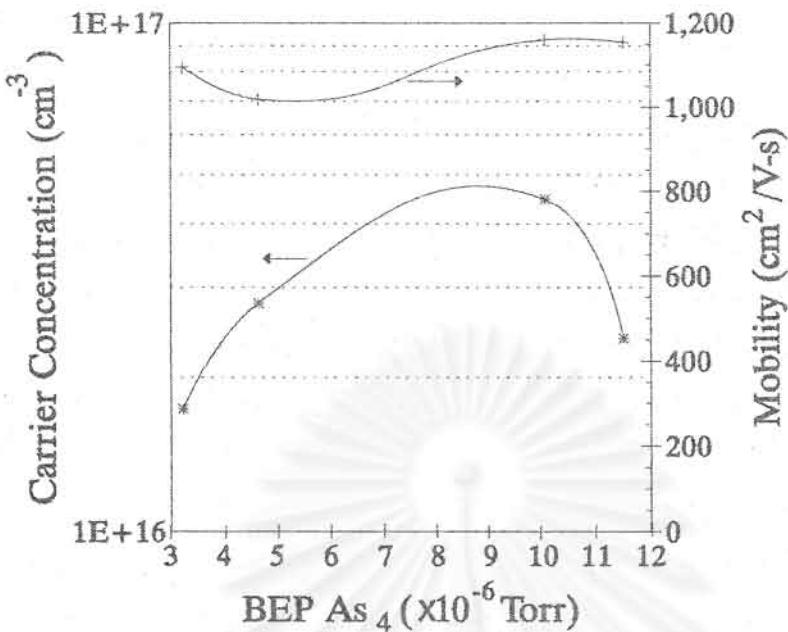
ค่าอยู่ในช่วง  $2.2 \times 10^{16}$  -  $3.12 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$  และค่าความคล่องตัวมีค่าอยู่ในช่วง 708-1,792  $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$  ที่ อุณหภูมิห้อง โดยอิทธิพลของอุณหภูมิจะทำ การปั๊กผลึกมีผลดังนี้ ที่อุณหภูมิจะทำการปั๊กผลึกที่ 440 °C นั้น ค่าความเข้มข้นพาหะมีค่าอยู่ในช่วง  $2.2 \times 10^{16}$  -  $3.12 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$  และค่าความคล่องตัวมีค่าอยู่ ในช่วง 708-1,792  $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$  โดยอิทธิพลของค่าความดันไอ As<sub>4</sub> มีผลต่อค่าความคล่องพาหะในกรณีนี้อย่าง เด่นชัด ซึ่งปรากฏการณ์นี้สามารถอธิบายได้จาก As Incorporation ในเนื้อผลึกหรือการแทรกเรียงตัวของ อะตอม As ในโครงผลึก ที่อุณหภูมิจะทำการปั๊กผลึก 440 °C นี้มีความดันไอ As<sub>4</sub> มีผลทำให้ค่า ความคล่องพาหะลดลงอย่างรวดเร็วในการกรณีที่ค่าความดันไอ As<sub>4</sub> ต่ำกว่า  $6 \times 10^{-6}$  Torr อันเนื่องมาจากการ ของค่าความดันไอ As<sub>4</sub> ที่มีค่าต่ำทำให้เนื้อผลึกมีตำแหน่งขาดหายไปของ As อันทำให้เกิดจุดบกพร่องขึ้น (Defect) ขึ้นภายในเนื้อผลึก โดยจุดบกพร่องนี้ทำให้เกิดจากกระเจิง (Scattering) ขึ้น อันเป็นสาเหตุทำให้ ค่าความคล่องตัวมีค่าลดลง สำหรับกรณีที่ค่าความดันไอ As<sub>4</sub> กว่า  $9 \times 10^{-6}$  Torr อะตอม As ส่วนเกินนั้น เกิดจากการแทรกตัวในตำแหน่งที่ไม่ไหตำแหน่งของอะตอมในโครงผลึก ทำให้อะตอม As ที่อยู่ผิดตำแหน่งนี้ทำให้เกิดจากกระเจิงอันเนื่องมาจากการอยู่ผิดตำแหน่งของ As ในโครงผลึก จากผลการทดลอง ในเงื่อนไขค่าความดันไอ As<sub>4</sub> ที่เหมาะสมอยู่ในช่วง  $6 \times 10^{-6}$ - $9 \times 10^{-6}$  Torr สำหรับการปั๊กผลึกที่อุณหภูมิ 440 °C ซึ่งได้ค่าความคล่องตัวพาหะสูงสุดในกรณีนี้



รูปที่ 4.6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้นพาหะ ค่าความคล่องตัวและค่าความดันไอ As<sub>4</sub> ภายใต้เงื่อนไขการปลูกผลึกที่อุณหภูมิแผ่นผลึกฐาน 460 °C

สำหรับในกรณีที่อุณหภูมิขณะทำการปลูกผลึก 460 °C นั้นมีลักษณะคล้ายกับกรณีของอุณหภูมิขณะทำการปลูกผลึก 440 °C สำหรับค่าความเข้มข้นพาหะมีค่าอยู่ในช่วง  $1.73 \times 10^{16}$  -  $4.48 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$  และค่าความคล่องตัวมีค่าอยู่ในช่วง  $1,018$ - $1,160 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$  ที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งค่าความคล่องตัวพาหะในกรณีนี้ มีความแตกต่างกันไม่มากนัก โดยค่าความดันไอ As<sub>4</sub> ที่เหมาะสมมีค่าอยู่ในช่วง  $1 \times 10^{-5}$ - $1.2 \times 10^{-5} \text{ Torr}$  ซึ่งค่าความคล่องพาหะที่ได้มีค่าต่ำกว่ากรณีของอุณหภูมิขณะทำการปลูกผลึก 440 °C จึงแม้ว่าค่าอุณหภูมิขณะทำการปลูกผลึกมีค่าสูงขึ้นก็ตาม แต่จำนวนจุดบกพร่องจากอะตอมในโครงผลึกขาดหายไปหรืออยู่ผิดตำแหน่งไม่ได้ลดลงตาม และค่าความคล่องตัวพาหะในกรณีมีค่าเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่อค่าความดันไอ As<sub>4</sub> มีเพิ่มขึ้น

สำหรับในกรณีที่อุณหภูมิขณะทำการปลูกผลึก 480 °C นั้นมีลักษณะคล้ายกับกรณีของอุณหภูมิขณะทำการปลูกผลึก 440 °C ค่าความเข้มข้นพาหะมีค่าอยู่ในช่วง  $1.67 \times 10^{16}$  -  $3.45 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$  และค่าความคล่องตัวมีค่าอยู่ในช่วง  $700$ - $1,179 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$  ที่อุณหภูมิห้อง โดยค่าความดันไอ As<sub>4</sub> ที่เหมาะสมมีค่าอยู่ในช่วง  $7 \times 10^{-6}$ - $1.1 \times 10^{-5} \text{ Torr}$  โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงค่าความเข้มข้นพาหะมีค่าสูงขึ้นเมื่อค่าความดันไอ As<sub>4</sub> มีค่าเพิ่มขึ้นสำหรับค่าความดันไอ As<sub>4</sub> ที่ต่ำกว่า  $7 \times 10^{-6} \text{ Torr}$  และมีค่าความคล่องตัวไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดเมื่อค่าความดันไอมีค่า As<sub>4</sub> มีค่าสูงกว่า  $7 \times 10^{-6} \text{ Torr}$  สำหรับอิทธิพลของค่าความดันไอที่มีต่อค่าความคล่องตัวนั้น โดยค่าความคล่องพาหะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อค่าความดันไอ As<sub>4</sub> ค่าต่ำกว่า  $7 \times 10^{-6} \text{ Torr}$  ซึ่งค่าความคล่องตัวพาหะมีค่าต่ำเมื่อค่าความดันไอ As<sub>4</sub> มีค่าต่ำ และมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อค่าความดันไอมี



รูปที่ 4.7 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้นพาหะ ค่าความคล่องตัวและค่าความดันไอ As<sub>4</sub> ภายใต้เงื่อนไขการปั๊กผลึกที่อุณหภูมิแผ่นผลึกฐาน 480 °C

ค่า As<sub>4</sub> มีค่าสูงกว่า  $7 \times 10^{-6}$  Torr โดยค่าความคล่องตัวพาหะมีลักษณะอิ่มตัวเมื่อค่าความดันไอมีค่าสูงขึ้น เนื่องจาก As<sub>4</sub> สามารถแทรกเรียงในผลึกได้ดีที่อุณหภูมิสูง สำหรับอะตอน As ส่วนเกินในกรณีไม่มีผลต่อ ค่าความคล่องตัวพาหะ เนื่องจากการระเหิดของ As ที่อุณหภูมิสูงกว่าการณ์ของอุณหภูมิจะทำการปั๊กผลึก 440 °C เนื่องจากผลของการปั๊กผลึกที่สูงขึ้นทำให้ As Incoporation ในเงื่อนไขนี้มีค่าสูงขึ้นสำหรับในกรณีนี้ และค่าความเข้มข้นพาหะในกรณีมีค่าเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่อค่าความดันไอ As<sub>4</sub> มีเพิ่มขึ้น

จากผลการทดลองนี้เงื่อนไขการปั๊กผลึก InGaAs บน GaAs ที่อุณหภูมิแผ่นผลึกฐาน 440-480 °C นั้นสามารถสรุปได้ดังในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ค่าความเข้มข้นพาหะและค่าความคล่องตัวพาหะของตัวอย่างจากการปั๊กผลึก ที่อุณหภูมิ 440-480 °C

Growth Temperature (°C)	ค่าความเข้มข้นพาหะ (cm <sup>-3</sup> )	ค่าความคล่องตัวพาหะ (cm <sup>2</sup> /V.s)
440	$2.2 \times 10^{16} - 3.12 \times 10^{16}$	708-1,792
460	$1.73 \times 10^{16} - 4.48 \times 10^{16}$	1,018-1,160
480	$1.67 \times 10^{16} - 3.45 \times 10^{16}$	700-1,179

#### 4.5 ผลการวัดไฟโอลูมิเนสเซนซ์

ผลการวัดไฟโอลูมิเนสเซนซ์จากตัวอย่างที่ได้สร้างขึ้นนี้ไม่มีตัวอย่างใดที่สามารถวัดผลได้ อันเนื่องมาจากผลของการบกพร่อง (Defect) ในเนื้อผลึกที่ลดTHONคุณสมบัติการเปล่งแสงของ InGaAs รวมถึงการรวมตัวแบบ Auger ที่เกิดขึ้นใน InGaAs วิธีการปรับปรุงคุณภาพคุณสมบัติการเปล่งแสงของ InGaAs บนแผ่นผลึกฐานเริ่มต้น GaAs สามารถทำได้หลายวิธี เพื่อลดความบกพร่องในเนื้อผลึก ได้แก่ การใช้ Buffer มีคุณลักษณะ Graded GaAs-InGaAs การใช้  $In_{0.53}Ga_{0.47}As/In_{0.52}Ga_{0.48}As$  superlattice เป็นชั้น Buffer และการใช้ InP เป็นชั้น Buffer เป็นต้น โดยชั้น buffer ต่างๆ เหล่านี้ทำหน้าที่ในการลดความเครียดในชั้น InGaAs และทำเกิดความบกพร่องในชั้นผลึก InGaAs ลดลง หรือมีความบกพร่องน้อยกว่ากรณีที่ปลูก InGaAs ลงบน GaAs โดยตรง [29] นอกจากนี้สารประกอบ InGaAs ( $E_g \approx 0.75$  eV) หรือ  $In_{0.53}Ga_{0.47}As$  มีผลของการ Auger recombination ที่ทำให้ประสิทธิภาพการเปล่งแสง [30] โดยการรวมตัวแบบ Auger recombination เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสารกึ่งตัวนำที่มีค่าซองว่างແฉบพลังงานเล็ก

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 5

### สรุป

ในโครงการวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาเงื่อนไขในการปั๊กผลีกชั้นอิพิเทกซ์ InGaAs ( $E_g \approx 0.75$  eV) บนแผ่นผลีกฐานเริ่มต้น GaAs (100) ด้วยวิธีการปั๊กผลีกอิพิเทกซ์จากจำโนเลกุล โดยคุณสมบัติของชั้นผลีกอิพิเทกซ์ InGaAs ( $E_g \approx 0.75$  eV) ที่ได้ขึ้นกับเงื่อนไขหรือตัวแปรที่ใช้ในการปั๊กผลีก ได้แก่ ค่าอุณหภูมิแผ่นผลีกฐานขณะทำการปั๊กผลีกและค่าอัตราส่วนความดันไอ BEP ของ  $\text{As}_4/(\text{Ga}+\text{In})$  ซึ่งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในการปั๊กผลีก InGaAs ( $E_g \approx 0.75$  eV) อยู่ในช่วง 440-480 °C โดยค่าความดัน BEP ของ  $\text{As}_4$  ในช่วง  $7 \times 10^{-6}$ - $1 \times 10^{-5}$  Torr สำหรับค่าอัตราการปั๊กผลีก 0.5 μm/ชั่วโมง ซึ่งค่าความดันไอของ Ga และ In มีค่า  $1.1 \times 10^{-6}$  และ  $1.9 \times 10^{-5}$  Torr ตามลำดับ จากการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบด้วย X-RAY Diffraction ค่าคงตัวผลีกของ InGaAs ( $E_g \approx 0.75$  eV) มีค่าใกล้เคียงกับค่าคงตัวผลีกของ InP นอกจากนี้ สำหรับคุณสมบัติทางไฟฟ้าของชั้นผลีกอิพิเทกซ์ InGaAs ( $E_g \approx 0.75$  eV) บนแผ่นผลีกฐานเริ่มต้น (100) GaAs ที่ได้สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(ก) พาหะนำไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นอิเล็กตรอนหรือเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดเดื่น (n-type)

(ข) คุณสมบัติของผิวน้ำผลีก (Surface morphology) ที่ได้ขึ้นกับเงื่อนไขที่ใช้ในการปั๊กผลีกด้วย เช่นเดียวกัน โดยขึ้นกับอุณหภูมิแผ่นผลีกฐานขณะทำการปั๊กผลีกและค่าความดันไอ  $\text{As}_4$  ที่ใช้ในการปั๊กผลีก สำหรับในการทดลองนี้เงื่อนไขที่ให้คุณสมบัติของผิวน้ำผลีกตีที่สุดคือการปั๊กผลีกที่อุณหภูมิ 480 °C และใช้ค่าความดันไอ  $\text{As}_4$  ในช่วง  $6 \times 10^{-6}$ - $8 \times 10^{-6}$  Torr โดยค่า Surface roughness ที่ได้มีค่าประมาณ 4 nm.

(ค) ค่าความเข้มข้นพาหะมีค่าอยู่ในช่วง  $1.68 \times 10^{16}$ - $4.48 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$  และมีค่าความคล่องตัวพาหะอยู่ในช่วง  $700$ - $1,791 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$  ที่อุณหภูมิห้อง สำหรับในการถีนี้เงื่อนไขที่ให้ค่าความคล่องตัวพาหะสูงสุดคือ การปั๊กผลีกที่อุณหภูมิ 440 °C และใช้ค่าความดันไอ  $\text{As}_4$  ในช่วง  $7 \times 10^{-6}$ - $9 \times 10^{-6}$  Torr โดยค่าความคล่องตัวพาหะสูงสุดคือ  $1,791 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 6

### ข้อเสนอแนะ

สำหรับงานวิจัยนี้ค่าอุณหภูมิที่ใช้ในการทดลองนี้เป็นค่าที่ได้จากการเบริยนเทิบจากรูปแบบของ RHEED ที่จุดเปลี่ยนแปลงต่างๆ บนผิวน้ำของ GaAs (100) ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนมากกว่า  $10^{\circ}\text{C}$  ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดคือการใช้ IR Pyrometer แต่เครื่องมือนี้มีราคาแพง สำหรับอีกวิธีการหนึ่ง ได้แก่ การใช้โลหะหรือวัสดุที่มีค่าจุดหลอมเหลวในช่วงที่เราทำงาน เช่น Al มีค่าจุดหลอมเหลว  $660^{\circ}\text{C}$  หรือ InSb มีค่าจุดหลอมเหลว  $525^{\circ}\text{C}$  ติดลงบนแผ่นพลาสติกฐานที่ติดไว้บน Mo Block และทำการเบริยนเทิบค่าที่ได้จาก IR Pyrometer หรือค่าที่ได้จาก Thermocouple เพื่อให้สามารถคำนวณค่าอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น แต่วิธีการนี้ยุ่งยากและไม่เหมาะสมสำหรับการงานในช่วงอุณหภูมิที่กว้างมากได้ หากใช้ในการผลิตเชิงพาณิชย์จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ IR Pyrometer นี้ เพื่อให้การผลิตสามารถทำซ้ำได้ (Repeatability) นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นต้องตรวจสอบคุณสมบัติของโครงผลึกด้วย X-ray ซึ่งเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับงานนี้คือ Double Crystal X-ray Diffractometer เนื่องจากไม่มีเครื่องมือชนิดนี้ในประเทศไทย และเป็นเครื่องมือหลักของการวิจัยด้านสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ และวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิเคราะห์ค่าคงตัวผลึก (Lattice constant) ค่าความหนาของชั้นผลึก โดยเฉพาะวัสดุสารประกอบชนิด 3 ชาตุ (Ternary) และชนิด 4 ชาตุ (Quaternary) โดยเครื่องมือ X-ray นี้สามารถบอกค่าความแตกต่างของค่าคงตัวผลึกของชั้นผลึกที่ประกอบกันขึ้นเป็นโครงสร้างสิ่งประดิษฐ์ ดังนั้นถ้ามีความพร้อมของอุปกรณ์การวิจัยทางด้านวัสดุอิเล็กทรอนิกส์จะทำให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ผลงานการวิจัยนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำการวิจัยสารประกอบอื่นๆ เช่น GaSbAs, InGaAlAs และ GaPSb เพื่อนำมาใช้ในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ชนิดอื่นๆ ต่อไป โดยการใช้ InGaAs เป็นชั้น Buffer ก่อนทำการปั๊กผลึกหลักที่เราต้องการปั๊ก ขณะผู้วิจัยหวังไว้ว่าในโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยจะได้การสนับสนุนและส่งเสริมต่อไปในอนาคต

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ເອກສານອຳນວຍ (Reference)

1. Handbook of Semiconductor Lasers and Photonic Integrated Circuits, Edited by Y. Suematsu and A. R. Adams, Chapman & Hall, 1994.
2. Principle and Application of Optical Communication, Max Ming-Kang Liu, IRWIN, 1996.
3. InP Materials and Devices : Physics and Technology, Edited by Osamu Wada and Hideki Hasegawa, John Wiley and Sons, Inc., 1999.
4. Physical Properties of III-V Semiconductor Compounds, Sadao Adachi, John Wiley & Sons, Inc., 1992.
5. Nakagawa S., Hall E., Almuneau G., Kim J. K., Buell D.A., Kroemer H., Coldren L. A., "1.55  $\mu\text{m}$  InP-lattice-matched VCSELs with AlGaAsSb-AlAsSb DBRs", IEEE Journal on Selected Topics in Quantum Electronics, Vol. 7, No. 2, 2001, pp.224-230.
6. Yejin Zhang, Weiyou Chen, Aijun Wang, Heng Jiang, Caixia, and Shiyong Liu, "Design of the Active Structure of High-Performance 1.55  $\mu\text{m}$   $\text{In}_{1-x}\text{Ga}_x\text{Al}_x\text{As}$  Strained MQW Lasers", IEEE Journal of Quantum Electron., Vol.37, No. 7, 2001, pp. 923-927.
7. J. Minch, S. H. Park, T. Keating, and S. L. Chuang, "Theory and Experiment of  $\text{In}_{1-x}\text{Ga}_x\text{As}_y\text{P}_{1-y}$  and  $\text{In}_{1-x}\text{Ga}_x\text{Al}_x\text{As}$  Long-Wavelength Strained Quantum-well Lasers", IEEE Journal of Quantum Electron., Vol.35, No. 5, 1999, pp. 771-782.
8. Salem A. F., Brennan K. F., "Theoretical study of the response of InGaAs metal-semiconductor-metal photodetectors", IEEE Journal of Quantum Electron., Vol.31, No. 5, 1995, pp. 944-953.
9. D. Strittmatter A., Kollakski S., Droege, E. Bottcher, E. H. Bimberg, "High speed high efficiency resonant-cavity enhanced InGaAs MSM photodetectors", Electronics Letters, Vol. 32, Issue 31, 1996, pp. 1231-1232.
10. Lamarre P., McTaggart R., Pulley M., Huang J., Jackson G., Ohmic contacts with difference metal structures for lattice matched InP based heterostructures", Conference Proceedings Fifth International Conference and Related Materials, 1993, pp. 333-336.
11. John R. Arthur, "Molecular beam epitaxy", Surface Science, Vol. 500, 2002, pp. 189-217.
12. Tsunenori SAKAMOTO, Hideo FUNABASHI, Kimihiro OHTA, Tadashi NAKAGAWA, Naoyuki KAWAI, and Takeshi KOJIMA, "Phase-Locked epitaxy using RHEED Intensity Oscillation", Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 23, No. 9, 1984, pp. L657-L659.
13. Yoshiji HORIKOSHI, Minoru KAWASHIMA, and HIROSHI YAMAGUCHI, "Migration-Enhanced Epitaxy of GaAs and AlGaAs", Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 27, No. 2, 1986, pp. 169-179.

14. Tomoya Shitara and Karl Eberl, "Electronic properties of InGaP grown by solid-source molecular beam epitaxy with a GaP decomposition source", *Appl. Phys. Lett.*, Vol. 65 No. 3, 1994, pp. 356-358.
15. MBE Components & Accessories, Valved Arsenic Cracker Cells, RIBER, Febuary 1999.
16. M. A. Herman and H. Sitter, "Molecular Beam Epitaxy : Fundamentals and Current Status", Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1989, pp. 96.
17. A. S. Bracker, M. J. Yang, B. R. Bennett, J. C. Culberton, W. J. Moore, Surface reconstruction phase for InAs, AlSb and GaSb", *Journal of Crystal Growth*, vol. 220, 2000, pp. 384-392.
18. B. Junno, S. Jeppesen, M.S. Miller, L. Samuelson, "A comparison of RHEED reconstruction phase on (100) InAs, GaAs and InP", *Journal of Crystal Growth*, vol. 164, 1996, pp. 66-70.
19. F. G. Celium Y. C. Kao, and H. Y. Liu, "In situ composition of InGaAs/InP using quadrupole mass spectrometry", *J. Vac. Sci Technol.*, Vol. A 14, No. 6, 1996, pp.3202-3207.
20. K. B. Ozanyan, P. J. Parbrook, M. Hopkinson, and C. R. Whitehouse, "In situ monitoring of the surface reconstruction on InP (100) prepared by molecular beam epitaxy", *J. Appl. Phys.*, Vol. 82, No. 1, 1997, pp. 474-476.
21. GaInAsP Alloy Semiconductor, Edited by T. P. Pearsal Wiley & Sons, 1982, pp. 92.
22. Data in Science and Technology, Edited in Chief : R. Poershke, Semiconductor Group IV Elements and III-V Compound, Editor : O Madalung, Springer-Verlag, 1991.
23. InP-Based Materials and Devices, Edited by Osamu WADA and Hideki HASEKAWA, John Wiley & Sons, Inc., 1999.
24. L. J. Van der PAUW, "A Method of Measuring The Resistivity and Hall Coefficient on Lamellation of Arbitrary Shape", *Phillips Technical Review*, Vol. 20, 1958, pp. 220-224.
25. Yoshikazu Takeda, Akio Sasaki, Yujiro Imamura, and Toshinori Takagi, "Electron mobility and energy gap of  $In_{0.53}Ga_{0.47}As$  on InP substrate", *Journal of Applied Physics*, vol. 47, No. 12, 1976, pp.5405-5408.
26. F. G. Celli, Y. C. Kao and H.U. Liu, "In situ composition monitoring of InGaAs/InP using quadrupole mass spectrometry", *J. Vac. Sci. Technol.*, Vol. 17 A, No. 6, 1996, pp. 3202-3207.
27. RIBER MBE 32 Opertor's Guide, Instruction Manual, 1991, pp. 81-84.
28. J. A. Roth, D. H. Chow, G. L. Olson, P. D. Brewer, W. S. Williamson, B. Johs, "Real-time control of the MBE growth of InGaAs on InP", *J of Crystal Growth*, vol. 201/202, 1999, pp. 31-35.
29. Y. F. Chen, J. L. Shen, and I. M. Chang, S. Z. Chand and S. C. Lee, "Photoluminescence study of highly mismatched  $In_{0.53}Ga_{0.47}As$  epilayers grown on InP-coated GaAs substrates", *J Appl. Phys.*, vol. 77, No.3, 1995, pp. 1040-1042.

30. Theory of optical processes in semiconductors : Bulk and Microstructures, P.K. BASU,  
Oxford university press, 1997.





สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย